CODEN : GKSGA8 ISSN 1349-4465

# 群馬県立産業技術センター 研究報告

## 平成28年度

**Reports of** 

Gunma Industrial Technology Center

2016

## 群馬県立産業技術センター

#### 目 次

次世代産業創出研究

- 次世代無線通信センサネットワークを活用した IoT 支援に関する研究 ・・・・ 1 石黒 聡、藤井茂樹、細谷 肇
- 多孔質シリカ担時 Ni 試料の水素吸着能に関する検討 ・・・・・・・・・・・・・・ 6 恩田鉱樹、熊澤直人、塚本さゆり、 徳田敬二、鈴木 崇
- 輸出用に適した群馬清酒酵母の育種に関する研究 ・・・・・・・・・・・ 11 渡部貴志、高橋仁恵、増渕 隆

試験分析高度化研究

- ISO/IEC 17025 及び JCSS の登録更新に係る不確かさ評価 ・・・・・・・・ 1 5 川原潤也、増田直也
- 3D プリンタ出力用 CAD データの設計寸法の最適化検討
   ・・・・・・・・・
   18
   狩野幹大、須田高史、黒岩広樹
   新井宏章
- 深さ方向の残留応力分布の測定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22 荻野直彦、矢澤 歩
- 引張試験における画像処理を用いたひずみ測定手法の開発 ・・・・・・・ 27 新井宏章、荻野直彦、岩沢知幸、 鏑木哲志
- 検査システムの開発に関する研究 ・・・・・・・・・・・・・・・ 31 新井宏章、小宅 勝、鏑木哲志
- 毛髪混入異物の加熱履歴に関する研究 ・・・・・・・・・・・・・・ 36 梅澤悠介、五十嵐昭

金属ーガスーポリマー接触界面での

- 新しいタイプの成形不具合に関する解析技術の開発 ・・・ 40 熊澤直人、恩田鉱樹、和田智史、 鈴木 崇
- 定量性を備えた昇温脱離装置を用いた計測技術の開発・・・・・・・・・・・ 44 牛木龍二、恩田鉱樹

# 次世代産業創出研究

## 次世代無線通信センサネットワークを活用した IoT 支援に関する研究

石黒 聡・藤井茂樹・細谷 肇\*

Study on IoT support that utilized a next-generation wireless communication sensor network Satoshi ISHIGURO, Shigeki FUJII, Hajime HOSOYA

中小企業への IoT 支援をするために、次世代無線通信センサネットワークを活用したシステム構築の 基礎的な研究を行った。センサノードの温湿度センサ、測距センサで取得したデータを IoT ゲートウェ イを介してインターネット上のサービスである M2X を利用したグラフによる可視化や Twitter を利用 したメッセージの表示ができることを確認した。

キーワード: IoT、次世代無線通信、センサネットワーク

A basic study of the systems construction that utilized a next-generation wireless communication sensor network was done to support IoT in the medium and small-sized business. The data acquired by the temperature-humidity sensor and the distance sensor on the sensor node could be visualized using M2X or Twitter which is a service on the Internet through the IoT gateway.

Keywords : Internet of Things, Next-generation wireless communication system, Sensor network

#### 1 はじめに

最近、生産現場での IoT 活用の必要性が叫 ばれているが、実際に活用しているのは大企業 が多く、中小企業ではほとんど普及が進んでい ないのが現状である。理由は、IoT の意味合い や導入効果が不明確であるため投資ができな いことである。また、IoT はインターネットに つながっていることが重要であるが、生産現場 では IT 化も十分ではなく、LAN などのネッ トワーク自体が整備されていない状況である。

今後センターに対して中小企業からの IoT 支援の要望が高くなることが予想されるため、 IoT に関する技術的なノウハウを蓄積し、情報 提供できるようになることが必要である。

そこで本研究は、ネットワークが簡易に構築 できる無線を利用し、IoTのベース技術となる 様々なセンサからのデータを取得・保存する方 法について基礎的な研究を行った。

#### 2 研究方法

#### 2. 1 システムの概要

本システムは、センサで現場環境の状態をモ ニタリングし、そのデータをクラウド上に保存 して、遠隔地でも現場の状態をユーザーが確認 できることを想定したものである。また、中小 企業では、LAN などネットワーク自体が整備 されていないことも考えられるため、無線を使 用したネットワーク構成にした。

#### 2.2 システムの構成

システム構成を図1に示す。

機器は、センサを取り付け、情報を収集する デバイスである「センサノード」とインターネ ットに直接接続できないデバイスを中継する 機器である「IoT ゲートウェイ」で構成される。 センサノードの構成を表1に、IoT ゲートウェ イの構成を表2に示す。センサノードは、温湿 度センサ、測距センサおよび無線モジュールを 実装したマイコンボード Lazurite Sub-GHz を使用した。また、IoT ゲートウェイは、無線



図1 システム構成

モジュールと 3G 通信ドングルを実装したシ ングルボードコンピュータ Raspberry Pi3 を 使用した。

センサノードと IoT ゲートウェイ間の通信 には、次世代無線通信と呼ばれている 920MHz 帯の無線通信を使用した。920MHz 帯無線通 信は、Wi-Fiと比較して、干渉に強い、通信距 離が長い、消費電力が低いなどの特徴があり、 今後 IoT 向け通信での利用が期待されている。

X 1	
マイコンボード	Lazurite Sub-GHz (ラピスセミコンダクタ㈱)
プロトタイピング ボード	Prototyping Shield (秋月電子通商㈱)
温湿度センサ	HDC1000 (秋月電子通商㈱)
測距センサ	GP2Y0A21YK (シャープ(株))
920MHz 帯無線 モジュール	BP3596A (ローム(株))

表	1	セ	ン	サ	Ϊ	—	ド	の	構	成
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

#### 表2 IoT ゲートウェイの構成

シングルボード	Raspberry Pi3
コンピュータ	(ラズベリー財団)
920MHz 帯無線	Lazurite Pi Gateway+BP3596A
ボード	(ラピスセミコンダクタ㈱)
3G 無線ドングル	FS01BU (富士通ソフト㈱)
SIM カード	SORACOM Air (ソラコム㈱)

また、IoT ゲートウェイとインターネット間の 通信には、ソラコムが提供している IoT サー ビス「 SORACOM Air」を使用した。 SORACOM Air は、専用の SIM カードを購入 し、ソラコムの専用サイトでアカウントと SIM カードを登録することで、すぐに利用す ることができる。月額の利用料金は、SIM カ ード 1 枚の管理費用と従量課金の通信費を合 わせて 400 円程度である。SORACOM Air を 使用したインターネットへの接続は、携帯電話 と同じ 3G 回線の専用線を使用しているため、 セキュアな通信ができるようになっている。

そして今回は、遠隔地で現場の状態を確認す るために、2つのインターネットサービスを利 用した。1つ目は、温湿度センサから取得した データをクラウド上に保存し、グラフ化するた めに、AT&T 社の IoT 向けクラウドサービス 「M2X」を使用した。M2X は、10 デバイスま での接続と、1 デバイスあたり月に最大 100,000 データまで無料で保存することがで きる。また、指定されたフォーマットでデータ を送信するだけで、自動でグラフによる可視化 ができるようになっている。2 つ目は、測距セ ンサで 10cm 以下の距離を測定したときにユ ーザーにメッセージを発信するために、ツイッ ター社のメッセージングサービス「Twitter」



図2 制御プログラムの動作フロー

を使用した。

2.3 制御プログラムの開発

センサノードおよび IoT ゲートウェイの制 御プログラムの動作フローを図2に示す。

2.3.1 クラウドサービス (M2X) の初 期設定 M2X をプログラムから利用するに は、M2X の Web サイトで事前にアカウントを 作成し、デバイスを登録する。デバイスを登録 するとデバイスごとに「DEVICE ID」と

「PRIMARY API KEY」が設定されるので、 それぞれの値をプログラムに記述し、決められ た処理を実行することで、プログラムから M2X ヘデータを送信することができる。M2X の Web サイトでのデバイスの設定画面を図 3 に示す。

2.3.2 メッセージングサービス (Twitter)の初期設定 Twitter をプログ ラムから利用するには、Twitterの開発者向け Web サイトで事前にアカウントを作成し、利 用するアプリケーションの情報を登録する。ア プリケーションを登録すると「Consumer Key」、「Consumer Secret」、「Access Token」、

「Access Token Secret」が設定されるので、 それぞれの値をプログラムに記述し、決められ た処理を実行することで、プログラムから Twitter にメッセージを送信することができ る。**Twitter**の開発者向け **Web** サイトでの設 定画面を図4に示す。

ATATIOT Platform V		
M2X Devices	Solutions Deshboards	😭 - 💡 - 🕑 - Resources Help Hello, San
Devices > TH_Logger	Personal Account      OPVICESURE     OPVICESURE     OPVICESURE     OPVICESURE     OPVICESURE     OPVICESURE	Q. Search Devices Advanced Search
m_cogger w		
CREATED BY:		Mcs Paul co
CREATED BY: Sangi Gunma EMAL: gftcst01/egmail.com	DDVGC D2     (2158800-14/0414.088001/2004-24H     (2158800-14/0414.088001/2004-24H     (2158800-14/0448001/2004-24H     (2158800-14/044800-14/0448001/2004-24H     (2158800-14/044800-14/0448001/2004-24H     (2158800-14/044800-14/0448001/2004-24H     (2158800-14/044800-14/044800-14/044800-14/044800-14/044800-14/044800-14/044800-14/044800-14/044800-14/044800-14/044800-14/044800-14/04800-14/04800-14/04800-14/04800-14/044800-14/04800-14/044800-14/048000-14/048000-14/048000-14/048000-14/048000-14/048000-14/048000-14/048000-14/048000-14/048000-14/048000-14/048000-14/048000-14/048000-14/048000-14/0480000-14/0480000-14/0480000-14/0480000-14/0480000-14/0480000-14/0480000-14/0480000-14/0480000-14/0480000-14/04800000-14/04800000-14/048000000000-14/048000000-14/048000000-14/0480000000000000000000000000000000000	taos No tags ovaliable Device

図 3 M2X の設定画面



図 4 Twitter の設定画面

2.3.3 センサノードの開発 セン サノードの制御プログラムは、図 2 (a)の制御 フローをもとに、開発ツール Lazurite IDE を 使用して C 言語で開発した。開発ツールの画 面を図 5 に示す。

制御プログラムは、30 秒間隔で温湿度セン サから温度、湿度を取得し、測距センサから距 離を取得する。その後、カンマ区切りの文字列 にして、IoT ゲートウェイに送信するようにし た。Lazurite Sub-GHz の実行中の画面を図 6 に示す。

😌 NGate_SubGhz.c - Lazunti	a IDE	
ファイル 福美 プロジェクト	ワール へんプ	
2744 48 703221 21330 21340 21350		
HardwareServo           6/022           6/024 <td< td=""><td><pre>i define HCICOD OPFIDE ERB 0/0 /* Bit root temperature and hundity */</pre></td><td></td></td<>	<pre>i define HCICOD OPFIDE ERB 0/0 /* Bit root temperature and hundity */</pre>	
boot mode Start upload. Upload success Sucess to reset Lazurite		

#### 図5 開発ツール

这信 Distance = 20, Temperature = 25.18 degree, Humidity = 13.93% Distance = 20, Temperature = 25.19 degree, Humidity = 13.93% Distance = 20, Temperature = 25.15 degree, Humidity = 13.84% Distance = 10, Temperature = 25.16 degree, Humidity = 13.75% Distance = 20, Temperature = 25.14 degree, Humidity = 13.65%	🔫 シリアルモニタ						• X
Distance = 20, Temperature = 25.19 degree, Humidity = 13.93% Distance = 20, Temperature = 25.19 degree, Humidity = 13.93% Distance = 20, Temperature = 25.15 degree, Humidity = 13.84% Distance = 10, Temperature = 25.16 degree, Humidity = 13.75% Distance = 20, Temperature = 25.14 degree, Humidity = 13.65%					<u>ا</u> لخ	:(=	
Distance = 20, Temperature = 25.19 degree, Humidity = 13.93% Distance = 20, Temperature = 25.19 degree, Humidity = 13.93% Distance = 20, Temperature = 25.15 degree, Humidity = 13.84% Distance = 10, Temperature = 25.16 degree, Humidity = 13.75% Distance = 20, Temperature = 25.14 degree, Humidity = 13.65%	procunce - roy	remperature	- 20110	acgree,	11400147	- 10.000	
Distance = 20, Temperature = 25.19 degree, Humidity = 13.93% Distance = 20, Temperature = 25.15 degree, Humidity = 13.84% Distance = 10, Temperature = 25.16 degree, Humidity = 13.75% Distance = 20, Temperature = 25.14 degree, Humidity = 13.65%	Distance = 20,	Temperature	= 25.19	degree,	Humidity	= 13.93%	<u>^</u>
Distance = 20, Temperature = 25.15 degree, Humidity = 13.84% Distance = 10, Temperature = 25.16 degree, Humidity = 13.75% Distance = 20, Temperature = 25.14 degree, Humidity = 13.65%	Distance = 20,	Temperature	= 25.19	degree,	Humidity	= 13.93%	
Distance = 10, Temperature = 25.16 degree, Humidity = 13.75% Distance = 20, Temperature = 25.14 degree, Humidity = 13.65%	Distance = 20,	Temperature	= 25.15	degree,	Humidity	= 13.84%	
Distance = 20, Temperature = 25.14 degree, Humidity = 13.65%	Distance = 10,	Temperature	= 25.16	degree,	Humidity	= 13.75%	=
ד קוול יייי	Distance = 20,	Temperature	= 25.14	degree,	Humidity	= 13.65%	
לוות							-
277			ク	リア			

図 6 Lazurite Sub-GHz の実行画面

2. 3. 4 IoT ゲートウェイの開発

IoT ゲートウェイの制御プログラムは、図 2 (b) の制御フローをもとに、テキストエディタを使 用して ruby で開発した。テキストエディタの 画面を図 7 に示す。

制御プログラムは、センサノードからデータ を受信すると、日時、温度および湿度を決めら れたフォーマットでM2Xに送信するようにし た。また、測距センサから取得した距離が 10cm以下だった場合は、近くに物体を検知し たとして、Twitterに物体を検知した時刻、温 度、湿度を付加したメッセージを送信するよう にした。Raspberry Pi3の実行中の画面を図8

#### に示す。



#### 図7 テキストエディタ

ファイル(F) 編集(E) タブ(T) ヘルプ(H)		
PANID=0xABCD, rxAddr=0x5FA5, txAddr=0x5F59, Strings:: ObjectDetect, 10.00, 28.68, 27.92		^
*物体を検出しました、¥n現在の日時は2017-03-16 17:41:11 40900、温度は28.68℃ 温度は27.92%です PANID=0xABCD, rxAddr=0x5FA5, txAddr=0x5F59, Strings:: ObjectDetect, 10.00, 27.72, 23.02		
PANID=0xABCD, rxAddr=0x5FA5, txAddr=0x5F59, Strings:: ObjectDetect, 20.00, 27.08, 19.02		
PANID=0xABCD, rxAddr=0x5FA5, txAddr=0x5F59, Strings:: ObjectDetect, 10.00, 26.61, 16.19		
*物体を検出しました, ¥n現在の日時は2017-03-16 17:41:25 +0900、温度は26.61℃ 湿度は16.19%です PANID=0xABCD, rxAddr=0x5FA5, txAddr=0x5F59, Strings:: ObjectDetect, 10.00, 26.27, 14.44		10
PANID=0xABCD, rxAddr=0x5FA5, txAddr=0x5F59, Strings:: ObjectDetect, 10.00, 25.99, 13.37		v

図 8 Raspberry Pi3の実行画面

#### 3 研究結果

#### 3. 1 M2X によるグラフ化

センサノードから 30 秒間隔で取得した温度、 湿度を IoT ゲートウェイを介して M2X に送信 し、ブラウザ上で温度、湿度の測定グラフを表 示した結果を図 9、図 10 に示す。図 9、図 10 のように、IoT ゲートウェイから M2X に決め られたフォーマットでデータを送信するだけ で、自動でデータを保存し、グラフ化すること が確認できた。



図 9 M2X による温度のグラフ化



#### 図 10 M2X による湿度のグラフ化

3. 2 Twitter によるメッセージ発信

センサノードの測距センサから取得した距 離が 10cm 以下のとき、IoT ゲートウェイを介 して Twitter にメッセージを送信し、ブラウザ 上で表示した結果を図 11 に示す。図 11 のよ うに、メッセージの内容から物体を検出したと きの日時、温度および湿度を確認することがで きた。



図 11 Twitter によるメッセージ発信

#### 4 まとめ

次世代無線通信センサネットワークを利用 して、遠隔地でもユーザーが現場環境を確認で きるような、簡単かつ安価に構築できるシステ ムの基礎的な研究を行った。本研究では、セン サノードで温度、湿度、距離を取得し、920MHz 帯の無線通信を使用して IoT ゲートウェイを データの送受信を行い、SORACOM Air を利 用した 3G 通信でインターネット上のサービ スである M2X による温湿度データのグラフに よる可視化および Twitter によるメッセージ の発信をすることができた。今回使用した M2X や Twitter のサービスは、ブラウザ上で 表示できるため、ユーザーがインターネットに 接続することができる携帯端末等を持ってい れば、どこにいても確認することができる。

今後は、中小企業への実用化に向けた IoT 支援ができるように、信頼性やセキュリティを考慮した研究を行う予定である。

#### 参考文献

 1)「M2X で気温・湿度・気圧データをグラフ で楽々モニタリング」, <http://www.lapis-se mi.com/lazurite-jp/lazurite/1028.html> (201 7年2月8日アクセス)

2)「Twitter で気温・湿度・気圧をつぶやく」, <http://www.lapis-semi.com/lazurite-jp/laz urite/890.html> (2017 年 2 月 8 日アクセス) 3)「簡単に Raspberry Pi で SORACOM Air を使う (FS01BU USB モデムを用いて自動接 続), <http://qiita.com/dietposter/items/068 019ee53252206a6bf> (2017 年 2 月 8 日アク セス)

## 多孔質シリカ担持 Ni 試料の水素吸着能に関する検討

恩田紘樹・熊澤直人\*・塚本さゆり・徳田敬二\*・鈴木 崇\*\*

## Investigation of hydrogen adsorption capacity regarding nickel metals supported on porous silica Koki ONDA, Naoto KUMAZAWA, Sayuri TSUKAMOTO, Keiji TOKUDA and Takashi SUZUKI

多孔質化 SiO<sub>2</sub> に Ni を担持した試料(以下、Ni/pSiO<sub>2</sub>)の低温(-196 ℃)および高温(50 ℃)における水素吸着量を評価した。その結果、低温における Ni/pSiO<sub>2</sub> への水素吸着量は、 SiO<sub>2</sub> 担持 Ni 試料(以下、Ni/SiO<sub>2</sub>)への水素吸着量と比較して大きな違いが見られなかっ たのに対し、高温では 1.2 倍に増大した。また、Ni/pSiO<sub>2</sub> に Cu を添加したところ、化学 吸着した水素の吸着量はほとんど変化させずに脱離温度が 115.2 ℃から 99.6 ℃に低下し た。以上のことから、水素貯蔵の観点から吸着だけでなく脱着しやすさも重要であり、 Cu の添加によって水素吸着量の減少を抑制しながら脱着温度を低下できたことの技術的 な意義は大きいと考えられた。

キーワード:水素、物理吸着、化学吸着、ニッケル、銅、シリカ

Adsorption amount of hydrogen on Ni supported on porous silica (Ni/pSiO<sub>2</sub>) was evaluated at low temperature around -196 °C and at high temperature around 50 °C. The adsorption amount of hydrogen on the Ni/pSiO<sub>2</sub> specimen at low temperature was almost the analogous with that of Ni/SiO<sub>2</sub> specimen. In contrast to these, the adsorption amount observed at high temperature was increased 1.2 fold as much as that on non porous Ni/SiO<sub>2</sub> specimen. In addition, when temperature programmed desorption(TPD) of hydrogen was performed on Ni/pSiO<sub>2</sub> containing 1wt.% of Cu specimen, desorption peak temperature of chemisorbed hydrogen was shifted from 115.2 °C to 99.6 °C. From these results, it was worthy to mention that the absorbent should have large capacity of desorption as well as that of adsorption for hydrogen storage and carriage system. Finally, it might be important from engineering viewpoint that declining desorption temperature of hydrogen was achieved with small decrease of hydrogen adsorption by adding copper to Ni/SiO<sub>2</sub> specimen.

Keywords: hydrogen, physisorption, chemisorption, nickel, copper, porous silica

#### 1 はじめに

水素は燃焼時に水のみを生成し、化石燃料のように二酸化炭素を排出しないことからクリーン燃料ガスとして着目<sup>1)</sup>され、エネファーム<sup>2)</sup>や燃料電池車<sup>3)</sup>のように水素を燃料として利用する燃料電池の実用化が進んでいる。また、水素ステーションなど

の社会インフラの整備も進んでおり、今後 ますます水素の需要は高まると予想されて いる。水素の製造技術や輸送技術は大手石 油会社やガス会社を中心に既にほぼ確立さ れている<sup>4)</sup>。しかし、水素は現行燃料(天 然ガス、ガソリン、軽油等)と比較して体 積エネルギー密度が低く、貯蔵効率が低い という課題がある。このため、水素吸着材 を用いて水素を貯蔵できれば、より安全か つ低コストに水素貯蔵量を増加できる可能 性がある。水素吸着材には、水素を多く吸 着でき、かつ容易に水素を脱離できること が求められる。

これまでに我々は、水素の化学吸着能に 優れた Ni を高比表面積 SiO2(以下、 SiO<sub>2</sub>)に担持することにより、物理吸着だ けでなく、Ni への化学吸着により水素を 貯蔵する水素貯蔵材の開発に取り組んでき た の。本報告では、さらに、Ni の分散性 向上による化学吸着水素量の増大を目的に、 図1に示す様に SiO<sub>2</sub>に易燃性有機化合物 を混錬して打錠成形した後、焼成すること で多孔質化した SiO<sub>2</sub>(以下、pSiO<sub>2</sub>)に Ni を担持し、その水素吸着能を評価した。さ らに Ni/pSiO2 に対する化学吸着水素の吸 着力を適度に低減して脱離温度を下げ、水 素の脱離を容易にすることを目的に、第3 成分として Cu を添加し、脱離ピーク温度 変化について検討したので報告する。

#### 2. 実験

#### 2. 1 SiO<sub>2</sub> 担持 Ni 試料の調製

SiO<sub>2</sub>(Silica Gel60、比表面積 410m<sup>2</sup>/g、 Merck 製)を電気炉(FO-300、ヤマト科学 製)で 500 ℃で 2 時間焼成した。仕上がり の試料重量基準で Ni が 10wt%含有される よう、硝酸ニッケル六水和物(Ni(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>・ 6H<sub>2</sub>O、試薬特級、和光純薬製)にイオン交 換水を溶解させた。これにイオン交換水を 加え、飽和吸水量の約 1.2 倍容の硝酸ニッ ケル水溶液を調製した。この水溶液を予め 焼成した所定量の SiO2 に含浸させ、1 時 間静置した。得られたスラリーをロータリ ーエバポレーターに移し、50 ℃に加温し ながらアスピレーターで減圧乾燥後、石英 製炉心管に移し、横型管状電気炉(KTF-30N、光洋製)で空気を約 200ml/min で通気 しながら 500 ℃で 2 時間焼成し、SiO2 担 持 Ni 試料(Ni/SiO<sub>2</sub>)の前駆体を得た。

#### 2. 2 pSi02 担持高分散型金属試料の調製

SiO2 に対し、易燃性有機化合物である 酒石酸を 2wt%となるように混合し、自動



図 1 pSi02 調製の模式図

乳鉢(ANM1000、日陶科学製)を用いて乳棒 を 100rpm、乳鉢を 6rpm で回転しながら 1 時間混合した。その後、手動油圧ポンプ (P-16B、理研精機製)を用い、打錠圧力 40MPa で直径 15mm の打錠成形体 SiO<sub>2</sub>を 得た。さらに 500℃で 1 時間焼成して酒石 酸を熱分解除去した後、乳鉢で破砕して 250 メッシュのふるいにかけ、これを pSiO2 担体とした。その後、§2.1 に記載 した方法と同様の方法により、試料重量基 準で Ni が 10wt%含有されるように担持し た。銅添加試料については、所定量の硝酸 銅三水和物(Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>·3H<sub>2</sub>O、試薬特級、 和光純薬製)を試料重量基準で Cu が 1wt% 含有されるように添加した。このようにし て pSiO<sub>2</sub> 担持 Ni 試料(以下、Ni/pSiO<sub>2</sub>)およ び pSiO<sub>2</sub> 担持 Cu-Ni 試料(以下、Cu-Ni/pSiO<sub>2</sub>)の前駆体を得た。

#### 2. 3 比表面積測定

高分散型金属含有試料の比表面積測定に は高速比表面積測定装置(AUTOSORB-1、 ユアサアイオニクス製)を用い、吸着ガス を窒素として BET3 点法 <sup>5)</sup>により測定した。

#### 2. 4 水素昇温脱離(H<sub>2</sub>-TPD)

触媒物性試験装置(BEL-CAT、日本ベル 製)を用い、水素を流量 50ml/min で流通し ながら 500 ℃で 1 時間、試料を水素還元 した後、50 ℃でアルゴンと水素の混合ガ ス(アルゴン/水素=7/3)を流量 50ml/min で 流通しながら水素を飽和吸着させた。その 後、アルゴンを流量 50ml/min で流通しな がら 10 ℃/min で 500 ℃まで昇温し、試 料からの水素脱離温度を測定した。



図2 閉鎖循環系反応装置の模式図

#### 2.5 試料の活性化処理

高分散型金属含有試料前駆体あるいは pSiO<sub>2</sub> 担持 Ni 試料の前駆体を、図2に示 す体積既知の閉鎖循環系装置の固定床に 0.5g 設置し、500 ℃で1 時間真空加熱排 気した。閉鎖循環系装置内の圧力が 250Torr(33.3kPa)に到るまで水素を導入し、 また、トラップを液体窒素で冷却して還元 時に生成する水を除去し、500 ℃で1時間 還元した後、固定床の温度を 500℃に保持 しながら真空排気した。

#### 2. 6 水素吸着量測定

高分散型金属含有試料の活性化処理後、 固定床温度を 500 ℃に保持しながら閉鎖 循環系装置内の圧力が 380Torr(50.5kPa)に 到るまで水素を導入した。その後、固定床 温度を 50 ℃まで降温し、その際の系内圧 力の低下量に基づいて 50℃時点における 系内の水素減少量を算出した。この水素減 少量から、固定床に試料を設置せずに同様 の操作を行った場合の系内における水素減 少量を差し引き、これを高温(50℃)時の 試料への水素吸着量(高温吸着量)とした。 さらに固定床を液体窒素に 1 時間浸して 50℃から-196℃にまで降温した際の系内圧 力の低下量に基づき、-196 ℃時点におけ る系内の水素減少量を算出した。この水素 減少量から、固定床に試料を設置せずに同 様の操作を行った場合における系内の水素



図 3 Ni/SiO<sub>2</sub>および Ni/多孔質 SiO<sub>2</sub>1g 当たりの水素吸着量

減少量を差し引き、これを低温(-196℃) 時の試料への水素吸着量(低温吸着量)と した。さらに高温吸着量および低温吸着量 の和を総吸着量とした。

#### 3. 結果および考察

#### 3. 1 Ni/pSiO2の水素吸着能

前報にて、WII族金属であるNi、Coおよび Feのうち、Niが最も水素吸着能が高いこと を示した<sup>の</sup>。そこで、Niの分散性向上によ る化学吸着水素量増大を目的に、§2.2に記 載の方法でNi/pSiO₂を調製した。

図3に、Ni/SiO<sub>2</sub>およびNi/pSiO<sub>2</sub>1g当たり の総吸着量、低温吸着量および高温吸着量 を示す。Ni/SiO<sub>2</sub>の総吸着量、低温吸着量 および高温吸着量はそれぞれ1.003mmol/g、 0.769mmol/gおよび0.234mmol/mlだったの に対し、Ni/pSiO<sub>2</sub>ではそれぞれ1.062mmol/g、 0.782mmol/gおよび0.280mmol/gだった。ま た、Ni/SiO<sub>2</sub>およびNi/pSiO<sub>2</sub>についてH<sub>2</sub>-TPD 測定を行ったところ、高温吸着水素の脱離 ピーク温度はそれぞれ128.0℃および115.2 ℃だった。なお、Ni/SiO<sub>2</sub>およびNi/pSiO<sub>2</sub>の 比表面積はそれぞれ196m<sup>2</sup>/gおよび198m<sup>2</sup>/g だった。

低温吸着量はNi/pSiO<sub>2</sub>とNi/SiO<sub>2</sub>とでほと んど差が見られなかった。これは低温吸着 水素が主に吸着量が試料の比表面積に依存 する物理吸着水素である<sup>の</sup>ためと考えられ

	水	高温吸着水素の		
	低温吸着量	温吸着量 高温吸着量 総吸着量		脱離ピーク温度(℃)
Ni/pSiO <sub>2</sub>	0.782	0.280	1.062	115.2
Cu-Ni/pSiO <sub>2</sub>	0.783	0.253	1.036	99.6

表 1 Cu-Ni/pSiO2 への水素吸着量および高温吸着水素の脱離ピーク温度

た。これに対し、高温吸着量は $Ni/pSiO_2$ の 方が $Ni/SiO_2$ と比較して多かった。これは、  $Ni/pSiO_2$ では $Ni/SiO_2$ よりもNiが高分散に担 持され、水素の化学吸着サイトが増加した ためと考えられた。

一方、Ni/pSiO<sub>2</sub>における高温吸着水素の 脱離ピーク温度はNi/SiO<sub>2</sub>と比較して12.8℃ 低くなった。これは、Niの分散性向上に伴 い、酸化状態が高くなり、化学吸着水素の 吸着力が弱くなったためと考えられた。

#### 3. 2 Cu-Ni/pSiO2の水素吸着能

水素貯蔵の観点から、水素吸着能が高い だけでなく、容易に脱着できることも重要 である。そこで、Niの酸化状態を高める ことで化学吸着水素の吸着力を低減し、脱 離温度を下げることを目的に、Niよりも 電気陰性度の大きい Cu を添加した Cu-Ni/pSiO<sub>2</sub>を§2.2 に記載の方法で調製した。

表1に、Ni/pSiO<sub>2</sub> および Cu-Ni/pSiO<sub>2</sub>1g 当たりの総吸着量、低温吸着量、高温吸 着量および高温吸着水素の脱離ピーク温 度を示す。

Ni/pSiO<sub>2</sub>の総吸着量、低温吸着量および 高温吸着量はそれぞれ前述の通り 1.062mmol/g、 0.782mmol/g および 0.280mmol/g だったのに対し、Cu-Ni/pSiO<sub>2</sub> では、それぞれ 1.036mmol/g、 0.783mmol/g および 0.253mmol/g だった。 また、Cu-Ni/pSiO<sub>2</sub>の比表面積は 197m<sup>2</sup>/g だった。さらに H<sub>2</sub>-TPD による高温吸着 水素の脱離ピーク温度は Ni/pSiO<sub>2</sub> で 115.2 °Cだったのに対し、Cu-Ni/pSiO<sub>2</sub> では 99.6 °Cだった。

Ni/pSiO<sub>2</sub> と Cu-Ni/pSiO<sub>2</sub> とで低温吸着量 に違いはほとんど見られなかったのは、両 試料の比表面積が同程度であり、物理吸着 水素量はほとんど変わらなかったためと考 えられた。これに対し、Cu-Ni/pSiO<sub>2</sub>の高 温吸着量は Ni/pSiO<sub>2</sub> のそれの 0.90 倍だった。これは、Cu-Ni/pSiO<sub>2</sub>では一部 Ni が水素の化学吸着能の低い <sup>8)</sup>Cu に被覆されたためと考えられた。

Cu-Ni/pSiO<sub>2</sub> における高温吸着水素の脱 離ピーク温度は Ni/pSiO<sub>2</sub> のそれと比較し て 15.6℃低下した。これは、Cu 添加によ り Ni の酸化状態が高くなり、水素の化学 吸着力が弱くなったためと考えられた。こ のように、Cu 添加により脱離ピーク温度 を低下できたことから、TSA(Temperature swing adosorption)での温度変動幅を小さく することが可能となり、プロセス設計上の メリットとなると考えられた。

#### 4. まとめ

① SiO<sub>2</sub> の多孔質化により高温吸着量が増加と高温吸着水素の脱離ピーク温度低下が見られた。これは、Ni の分散性向上により水素の化学吸着サイトが増加し、さらにNi の酸化状態が高くなり、化学吸着水素の吸着力が弱くなったためと考えられた。 ② Ni/pSiO<sub>2</sub> に Cu を添加することで高温吸着量は減少した。これは、Cu により Ni の一部が被覆されたためと考えられた。 ③ Ni/pSiO<sub>2</sub> に Cu を添加することで高温吸着水素の脱離ピーク温度が低下した。これ は Ni の酸化状態が高くなり、化学吸着水素の吸着力が弱くなったためと考えられた。

#### 文献

1)NEDO,水素エネルギー白書 2014, pp4
 2)堀田,表面科学,34, 154(2013).
 3)大仲,水素エネルギーシステム,34, 10(2009).
 4)岡田,安井,化学工学,77,46(2013).

- 9 -

5)H. C. Suciu, L. Gagea and M. Mocean, *Chem. Eng. Sci.*, **61**, 7831(2006).

6)恩田, 熊澤, 塚本, 徳田, 鈴木, 群馬産業技術センター研究報告(平成 27 年度),1(2015).

7) 化学便覧基礎編改訂 4 版,日本化学会 編,丸善(1993)

8)P. Siegbahn, M. Blomberg, I. Panas and U. Wahgren, *Theo. Chim. Acta*, **75**, 143 (1989).

## 輸出用に適した群馬清酒酵母の育種に関する研究

渡部貴志・高橋仁恵・増渕 隆

## Breeding of non-urea producing Gunma sake yeasts which are suitable for export Takashi WATANABE, Hitoe TAKAHASHI, Takashi MASUBUCHI

清酒の海外輸出量は年々増加傾向にあるが、清酒中に含まれるカルバミン酸エチルの規 制値を設ける国が増えてくると懸念されている。カルバミン酸エチルは、国際がん研究機 関(IARC)によって「ヒトに対する発ガン性がおそらくある」とされるグループ2Aに 属する化合物である。そこで本研究では、清酒中のカルバミン酸エチル含有量を減らす目 的で、その前駆物質である尿素を生産しない群馬県独自の清酒酵母を育種することにした。 本年度は、群馬KAZE酵母の尿素非生産化に成功したので報告する。

キーワード:清酒、群馬清酒酵母、尿素非生産性、カルバミン酸エチル

Although, export volume of Japanese sake has been gradually increased, it is considered that the countries regulating volume of ethyl carbamate in Japanese sake, would be also increased. Ethyl carbamated is classified the group 2A "probably the cause of cancer" by International Agency for Research on Cancer (IARC). Therefore, the purpose of this study was to reduce the volume of ethy carbamate in Japanese sake, we attempted to breed Gunma sake yeasts which do not produce urea as a precursor of ethyl carbamate. In this year, we succeed to obtain the candidates from Gunma sake yeast KAZE2.

Keywords: Japanese sake, Gunma sake yeast, non-urea productivity, ethyl carbamate

#### 1 はじめに

清酒は、我が国の主食である米を醸して 造る伝統的な酒類であり、國酒として親し まれてきた<sup>1)</sup>。また、清酒の風味は地域性 に富み、国内各地の郷土料理とともに独自 の飲食文化を形成してきた。さらに、米の 精白技術の向上により、吟醸酒は近代にな ってから開発された清酒であり、常に時代 とともに清酒は進化している。当係では、 酒造組合と共同で県独自の吟醸用酵母の開 発に取り組んできており、群馬KAZE酵母 として県内酒蔵に広く普及している<sup>2)</sup>。さ らに、県農業技術センターと共同で県独自 の酒造好適米「舞風」も開発している<sup>3)</sup>。

一方、欧米諸国からは吟醸酒がライスワ インとして認知され、親しまれてきており、 近年の日本食ブームで海外輸出量は年々増 え、Ginjyo-shuという名前も浸透しつつ ある。特に地元産の米や水、酵母で造られ る地酒は、ワインでいうテロワールという 観点から、欧米諸国から好まれている。

ところが、海外輸出量増加に伴い、清酒 中に含まれるカルバミン酸エチルに規制値 を設ける国が増えてくることが懸念されて いる。カルバミン酸エチルは、国際がん研 究機関(IARC)によって「ヒトに対する 発ガン性がおそらくある」とされるグルー プ2Aに属する化合物である。カルバミン 酸エチルは、清酒中の尿素とエタノールが 火入れ貯蔵中に縮合して生成する。したが って、清酒酵母が尿素を生産しなくなれば、 清酒のカルバミン酸エチルの生成量は低減 出来ると考えられ、既に実用例が報告され ている<sup>4)</sup>。しかしながら、県独自で開発し た酵母は、様々な遺伝子に変異が入ってお り、尿素非生産性にすることによって、そ の酵母がもつ優れた発酵特性・香気成分生 成能を損なう場合も想定される。

海外輸出においてテロワールという観点 からも、群馬KAZE酵母の果たす役割は大 きいため、その優れた醸造特性を維持しつ つ、尿素のみを生成しない新たな酵母を育 種する意義は大きい。昨年度の予備的検討 において、群馬KAZE酵母は既存の方法に よる尿素非生産化には至らなかった(非公 開)。本年度は、この原因を調べる為、群 馬KAZE酵母の親株である清酒酵母きょう かい901号(K901)などと比較しつつ、 群馬KAZE酵母に適した尿素非生産化の方 法を検討したので報告する。

#### 2 実験材料と方法

#### 2.1 供試酵母と使用培地

前年度と同様、群馬KAZE酵母の中で最 も使用頻度が高い、KAZE2号(KAZE2) を育種対象にした。清酒酵母きょうかい 701号(K701)、K901は日本醸造協会よ り購入したものを用いた。

前培養は、YM培地(酵母エキス3g/L、 麦芽エキス3 g/L、ペプトン5g/L、グルコ ース10 g/L)を用いた。窒素飢餓処理は、 無窒素YNBD培地(YNB w/o amino acids and ammonium sulfate 1.7 g/L、グルコ ース20 g/L)を用いた。尿素非生産性酵母 の選抜培地の組成の検討は、北本ら4)の CAO 培 地 (YNB w/o amino acids and ammonium sulfate 1.7 g/L、カナバニン 10 mg/L、アルギニン塩酸塩0.21 g/L、オ ルニチン塩酸塩0.84 g/L、グルコース20 g/L、寒天20 g/L)、Arg培地(CAO培地 の窒素源をアルギニンのみにしたもの)、 Orn培地(CAO培地の窒素源をオルニチン のみにしたもの)を基準にした。発酵試験 は、簡易発酵試験培地(酵母エキス10 g/L、 麦芽エキス30 g/L、ペプトン10 g/L、リン 酸一カリウム0.5 g/L、硫酸マグネシウム ・七水和物0.1 g/L、グルコース100 g/L) を用いた。

#### 2.2 選抜培地の検討

YM 5mL含む試験管に酵母を一白金耳接 種し、30℃にて24時間、150 rpmの往復 振とう培養、あるいは静置培養により酵母 の前培養を行った。得られた前培養液をそ のまま、あるいは滅菌蒸留水に置換したも の、無窒素YNBD培地で窒素飢餓処理をし たものを、それぞれ選抜培地に塗布し、 30℃で静置培養を行い、カナバニンによ る酵母の増殖抑制の有無を評価した。

#### 2.3 尿素非生産性酵母の選抜

北本らの方法<sup>4)</sup>に準処し、カナバニン耐 性となった候補株について、Arg培地で生 育できず、Orn培地で生育できるものを尿 素非生産性酵母として選抜した。

#### 2. 4 簡易発酵試験による尿素の定量

YM 5mLを含む試験管に酵母を一白金耳 接種し、30℃にて24時間、150 rpmの往 復振とう培養を行った。簡易発酵試験培地 20 mLを100 mL容三角フラスコに加え、 前培養液200 µLを接種し、15℃で7日間、 75 rpmの回転振とう培養を行った。培養 前後の重量減少量を計測した。

培養液10 mLを15 mL試験管に採取し、 遠心分離(3,000 rpm × 5分間)を行っ て、上清全量を新たな試験管に採取した。 遠心上清1 mLを1.5 mLチューブに分取し、 80℃で15分間加温を行うことで、残存す る酵素活性を失活させた。得られた試料の 尿素をF-kit 尿素/アンモニア(Roche Diagnostics GmbH, Germany)を用い、 アンモニアの値を差し引いて測定した。

#### 3 結果と考察

#### 3. 1 KAZE2の尿素非生産化方法

酵母の尿素生産は、アミノ酸の一種であ るアルギニンを酵母細胞内に取り込み、酵 素アルギナーゼの働きでアルギニンをアミ ノ酸のオルニチンと尿素に加水分解して行 われる。北本らは、アルギニンのアナログ 物質であるカナバニン耐性株の選抜により、 アルギナーゼの機能を欠損させることによ って、アルギニンから尿素への変換経路が 無くなり、酵母の尿素非生産化に成功した

及「 医扒咕地米什/ 時時の上月時間に子たる影音						
	窒素飢餓	pH 調整	K701	K901	KAZE2	
	無し	無し	+	+	++	
カナバニン硫酸塩	有り	無し	—	—	+	
	有り	有り	_	—	+	
	無し	無し	_	_	+	
カノハーン	有り	無し	_	—	±	
カナバニン+硫酸	有り	有り	_	_	+	

表1 選択培地条件が酵母の生育抑制に与える影響

++:生育が良い、+:生育する、:+:わずかに生育する、-:生育が抑制

4)。このCAO培地を用いた方法が優れてい る最大の特徴は、変異処理を施さなくても アルギナーゼ遺伝子(*CAR1*)の自然変異 株が得られることである。つまり、他の遺 伝子が変異を起こすことは、ほとんど無い と言っていいほど少なく、醸造特性に影響 を及ぼさないと考えられている。

一方、前年度の予備的検討では、確実に 尿素非生産性変異株を得ることを主眼とし てしまい、イオンビーム照射による変異処 理を施した検討に終始してしまった。この ため、KAZE2から尿素非生産性変異株が 得られない原因を明らかにすることが出来 ず、その対処方法が見出せなかった(非公 開)。そこで原点に立ち戻り、北本らが用 いたK701、K901も合わせて選択培地の検 討をすることで、KAZE2のCAO培地の生 育抑制条件を見つけることにした。

前年度の予備的検討では、イオンビーム 照射処理後の酵母細胞をYM培地などで回 復培養した後、無窒素YNBD培地で窒素飢 餓処理を行い、カナバニンの濃度を従来の 10 mg/Lから30 mg/Lに増やしたCAO培地 に塗布することで、ようやくカナバニンの 生育抑制がかかるようになった(非公開)。 また、イオンビーム照射処理に供する酵母 細胞は、通常の変異処理で用いられる好気 培養ではなく、嫌気培養により培養したも のを用いていた。一方、新潟県醸造試験場 によると、窒素飢餓処理は、カナバニンを 用いたCAO培地ではなく、カナバニンの 価格の5分の1で購入可能なカナバニン硫 酸塩を用いたCAO培地での、新潟酵母の 尿素非生産化検討の時に見出したものであ ることが判明した。これらの情報から、以 下の5つの問題点を検討する必要性が考え られた。

- ① CAO培地に塗布する酵母細胞の前培養条件は、好気培養と嫌気培養のどちらで行うべきか。
- ② CAO培地に塗布する酵母細胞は、窒素飢餓処理が必要であるのか。
- カナバニンとカナバニン硫酸塩のどちらを、KAZE2用の選択培地に用いることが適当であるのか。
- ④ カナバニンの添加量はどの程度が妥当であるのか。
- ⑤ カナバニン耐性酵母を取得する為には、どの程度の培養日数が必要か。

選択培地条件の結果の概要を表1にまと める。詳細について、上記の①については 好気培養の方が良く、②については前培養 液を滅菌水で置換するだけで良く、③につ いては、硫黄成分の蓄積がKAZE2のカナ バニン耐性に大きく影響を与えているよう であった。また、④について様々な組成で 検討したところ、アルギニンとオルニチン の濃度を既存のCAOの半量にするだけで

(カナバニン濃度は10 mg/Lのままで)、 KAZE2の完全な生育抑制が確認出来た。 さらに、⑤についてこれらの条件を整えた 後、KAZE2の自然変異によるカナバニン 耐性株の取得を試みたところ、4週間の培 養で、400枚のCAO培地から4株の候補株 が得られた。なお、北本らの報告では、 KAZE2の親株のK901からは、10枚の培地 から43株の候補株が得られており<sup>4)</sup>、単純 計算でKAZE2の取得率は、K901の430分 の1であることが分かった。

次に、得られた4株のカナバニン耐性株 に対し、尿素非生産性の指標となるアルギ ナーゼ欠損株の選抜を試みたところ、いず

	尿素(mg/L)		アンモ	ニア(mg/L)	重量派	重量減少量(g)		
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差		
KAZE2	ND	_	15.66	8.35	1.00	0.02		
K901	ND	_	18.97	5.61	1.00	0.04		
自然−1	ND	-	8.06	0.87	0.95	0.02		
自然−3	ND	-	8.47	0.64	0.99	0.04		
自然−4	ND	_	22.19	0.68	1.03	0.01		

表2 簡易発酵試験の結果のまとめ

れもOrn培地で生育し、そのうち3株が Arg培地で生育することが出来ない、アル ギナーゼ欠損株であることが確認出来た。

#### 3.2 発酵能と尿素生産性の評価

先の検討によって得られた酵母が、実用 規模の清酒造りに使用可能であるか評価す るためには、高い発酵能力が保持されてい ること、清酒の味や香りのバランスが優れ ていること、などを確認する必要がある。 このような評価を行う為には、実際の酒造 りを模した小仕込み試験を行う必要がある。 しかしながら、一回の小仕込み試験は、一 ヶ月以上の日数がかかってしまう為、大多 数の酵母の評価を1度に行うことは難しい。 したがって、今回は調製が容易な液体培地 である簡易発酵試験培地を用い、発酵試験 による酵母の発酵能力と尿素生産量を調べ た。

簡易発酵試験培地を用いた場合、酵母の 発酵能力を示す重量減少量については、差 が認められなかった(表2)。しかしなが ら、尿素を計算する際に差分の値となるア ンモニアの値のばらつきが、親株で特に大 きくなり、見かけの計算上は全ての酵母の 尿素生産量は検出限界以下であった。アン モニアは、尿素やアミノ酸の分解で生じて くる為、簡易発酵試験培地に用いていたペ プトンなどの窒素源から遊離してきたもの であると考えられる。これらのことから、 簡易発酵試験培地で尿素生産量を正確に評 価することは難しいと考えられた。一方で、 自然-1、自然-3のアンモニアの値は、親株 より低い値となっていたため、尿素非生産 性であると示唆されている。さらに、清酒 酵母の拡大培養に用いられる麹エキス培地 で培養してみたが、同様に尿素生産量の正

ND: 検出限界以下

確な検出は出来なかった(データ略)。し かし、麹エキス培地では、自然変異株の重 量減少量が低くなっており、大まかに酵母 を選抜するためには有用であった。今後は、 変異処理によりKAZE2の醸造特性を維持 した尿素非生産株の取得を試みる。

#### 4 まとめ

本研究では、清酒中のカルバミン酸エチ ル含有量を減らす目的で、その前駆物質で ある尿素を生産しないKAZE2の変異株の 取得に成功した。なお、尿素生産量の定量 には、液体培地は不適切であったが、麹エ キス培地では重量減少量の評価は適切に行 えていた。したがって、まずはその値を指 標に選抜し、酵母の数を絞った後で小仕込 み試験を行って、全体的な醸造特性と、尿 素生産性を評価することが、効率よく酵母 の尿素非生産化に繋がると考えられた。

#### 謝 辞

新潟県醸造試験場の佐藤圭吾主任研究員 に、選択培地の検討でご助言を頂いた。

#### 文 献

- 1) 和田美代子:日本酒の科学(2015)
- 2) 増渕 隆ら:平成17年度群馬産業技術
   センター研究報告、35-38
- 3) 増渕 隆ら:平成18年度群馬産業技術 センター研究報告、40-43
- 4) 北本勝ひこら:日本醸造協会誌、598-601 (1992)

# 試験分析高度化研究

## ISO/IEC 17025及びJCSSの登録更新に係る不確かさ評価

川原潤也·増田直也

## Evaluation of uncertainty with registration renewal of ISO/IEC 17025 and JCSS Junya KAWAHARA, Naoya MASUDA

JCSS校正では、校正担当者を変更した際に、人的誤差による不確かさを再評価する必要がある。このため、長さ校正に係る人的誤差の再調査を実施し、不確かさの値を算出した。調査の結果、JCSS登録値を修正する必要がないことを確認した。

キーワード: JCSS、不確かさ、最高測定能力、密着誤差、繰り返し誤差

In the framework of JCSS, when we change the person in charge of calibration, we need to reevaluate uncertainty caused by human errors. For this reason, we reexamined the human errors of measurement in calibration, and calculated the uncertainty values. In this study, we confirmed that it is not necessary to modify the JCSS registration values.

## Keywords: JCSS (Japan Calibration service system), Uncertainty, Best measuring ability, Error of ringing, Repeatability error

#### 1 はじめに

当センターは、公設試としては数少ない JCSS認定の長さ校正機関である。JCSS校 正に際しては、人的誤差や計器誤差等によ る測定値の不確かさを適切に評価しなけれ ばならない。特に人的誤差は、校正担当者 に依存してその値が変化するため、担当者 を変更する際には、測定値に付する不確か さの値を再評価する必要がある。

当センターでは、平成28年度の組織変 更に伴い、校正担当者が変更された。この ため、校正担当者を変更した際の人的誤差 に関する基礎データの取得を目的として、 ブロックゲージの光波干渉測定及びノギス ・マイクロメータを用いた測定が行われた。 これらの測定結果に基づいて人的誤差によ る不確かさの値を解析し、各測定機器の最 高測定能力を算出した。これらの値と当セ ンターの最高測定能力を比較して、JCSS 登録値の修正の要否について確認した。本 報では、この調査結果について報告する。

#### 2 研究方法

人的誤差に関する基礎データの取得を目 的として、ブロックゲージの光波干渉測定 及びノギス・マイクロメータを用いた測定 を行った。本測定では、次に示す人的誤差 ①から③について調査した。

- ブロックゲージとベースプレートのリ ンギングにおける密着誤差
- ② ブロックゲージ同士のリンギングにお ける密着誤差
- ③ ノギス・マイクロメータを用いた測定 における繰り返し誤差

人的誤差①は光波干渉測定、②③はノギス ・マイクロメータを用いた測定の最高測定 能力に影響を与える。人的誤差①による不 確かさは、15 mmのブロックゲージの光 波干渉測定の結果から解析した。人的誤差 ②による不確かさは、組み合わせ寸法が 10 mmとなるようにリンギングしたブロ ックゲージ(表1)を電子測微器で測定し た結果から解析した。人的誤差③による不確かさは、ノギス及びマイクロメータを用いて所定のブロックゲージ(表2、3)を 測定した結果から解析した。これらの不確かさの値を用いて各測定機器の最高測定能力を算出し、校正担当者変更前の最高測定能力(JCSS登録値)と比較する。各測定は校正担当者の川原と増田が行い、その方法は参考文献<sup>1)</sup>に記載のものと同様である。

表1 リ	ンギン	グし	たブ	ロッ	クゲー	ジ組	み合	わせ
------	-----	----	----	----	-----	----	----	----

No.	組み合わせ寸法 (mm)
1	4.5 + 5.5
2	4.0 + 6.0
3	3.5 + 6.5
4	3.0 + 7.0
<b>5</b>	2.5 + 7.5
6	2.0 + 8.0
7	1.5 + 8.5
8	1.0 + 9.0
9	0.5 + 9.5

表2繰り返し誤差取得のために使用したノギス

及びブロックゲージ

測定範囲 (mm)	最小目 盛	用いたブロック ゲージ寸法	備考
	(mm)	(mm)	
0-150	0.01	20,50,75,150	デジタル
0-200	0.05	20,50,100,150	アナログ
0-500	0.01	20,200,300,500	デジタル
0-500	0.05	20,200,300,500	アナログ

#### 表3繰り返し誤差取得のために使用したマイク ロメータ及びブロックゲージ

測定範囲 (mm)	最小目  (mm)	用いたブロック ゲージ寸法 (mm)	備考
0-25	0.001	5,15,25	デジタル
0-25	0.01	5,15,25	アナログ
25-50	0.001	25, 32.7, 50	デジタル
25-50	0.01	25,32.7,50	アナログ
50-75	0.01	50, 62.9, 75	アナログ
75-100	0.01	75,85.3,100	アナログ

#### 3 測定・解析結果

#### 3.1 光波干渉測定の不確かさ

光波干渉測定における不確かさの解析結 果を図1に示す。以後の図1から3の横軸は 各測定における不確かさの要因(下表を参 照)、縦軸は要因毎の不確かさの大きさを それぞれ表している。解析結果(図1の No.14)から、校正担当者を変更した際の 密着の不確かさは8 nmであることがわか った。この結果を用いて最高測定能力を算 出すると、その値は0.038 μmとなり、当 センターのJCSS登録値:0.040 μm以下と なることが確認された。

#### 3.2 ノギスを用いた測定の不確かさ

ノギスを用いた測定における不確かさの 解析結果を図2に示す。解析結果(図2の No.2、5)から、校正担当者を変更した際 の最大の繰り返し性の不確かさは5.50 µm、 密着の不確かさは0.03 µmであることがわ かった。これらの結果を用いて最高測定能



No.	不確かさの要因
1	レーザ光源の真空波長
2	干渉縞端数の読み取り
3	Edlénの式の不確かさ
4	気圧の測定
5	気温の測定
6	水蒸気圧の測定
7	炭酸ガス濃度
8	ブロックゲージの熱膨張係数
9	ブロックゲージの温度測定
10	ピンホールの補正
11	光学系のアライメント
12	コリメータレンズの焦点距離
13	光学的な位相差の補正値
14	密着
15	器差補正
16	デジタルエラー

図1 光波干渉測定における不確かさ

カを算出すると、最小目盛が0.01 mmのと きは0.01 mm (0.05 mmのときは0.03 mm)となり、最小目盛が0.01 mmのとき のJCSS登録値:0.02 mm (0.05 mmのと きのJCSS登録値:0.05 mm)以下となる ことが確認された。

## 3.3 マイクロメータを用いた測定の不 確かさ

マイクロメータを用いた測定における不 確かさの解析結果を図3に示す。解析結果 (図3のNo.2、7)から、校正担当者を変 更した際の最大の繰り返し性の不確かさは 0.71 µm、密着の不確かさは0.02 µmであ ることがわかった。これらの結果を用いて 最高測定能力を算出すると、その値は3.0 µmとなり、当センターのJCSS登録値: 3.1 µm以下であることが確認された。

#### 4 まとめ

人的誤差に関する基礎データの取得を 目的として、ブロックゲージの光波干渉測 定及びノギス・マイクロメータを用いた測 定を行い、校正担当者の変更が当センター の最高測定能力へ与える影響について調査 した。調査の結果(表4)、全ての測定機 器の最高測定能力が当センターのJCSS登 録値以下となったため、登録値の修正は必 要ないことが確認された。このことから、 校正担当者を変更したとしても、当センターの長さ校正の品質は維持されることが確 認された。

#### 参考文献

 増田、群馬産業技術センター研究 報告書、32-35 (2014)





図2 ノギスを用いた測定における不確かさ



No.	不確かさの要因
1	読み取りの分解能
2	繰り返し性/ランダム効果
3	基点設定の指示値
4	校正値の無補正
5	ブロックゲージの寸法の経年変化
6	基点設定のブロックゲージ長さ
7	リンギング(密着)の不確かさ
8	ブロックゲージ2枚使用
9	ノギスとブロックゲージの温度差
10	ノギスの温度と20℃からの偏差値

図3 マイクロメータを用いた測定おける不確か さ

恚∥	是立测史台	* ተ ጣ	冬2211	绿值	レ証	価値
衣 4	<b>取 向 測 疋 F</b>	Eノリの	1022 亞	<b>錸</b> 10(	と計	1回 1但

測定機器	最高測定能力 (拡張不確かさ)		単位	備考
	評価値	JCSS登録值		
ブロックゲージ	0.038 0.040		μm	100 mm以下が対象
- "-	0.01	0.02	mm	最小目盛0.01 mmのとき
7+7	0.03	0.05	mm	最小目盛0.05 mmのとき
マイクロメータ	3.0	3.1	μm	100 mm以下が対象

## 3D プリンタ出カ用 CAD データの設計寸法の最適化検討

狩野幹大・須田高史・黒岩広樹\*・新井宏章\*\*

## Optimization of design dimensions of CAD data for 3D printer Motohiro KANO, Takashi SUDA, Hiroki KUROIWA and Hiroaki ARAI

3D プリンタの高精度化に伴い、製品の試作工程においてモデルを造形して形状や組み付けの確認に活用する事例も増えているが、造形されたモデルの寸法の微小な誤差やばらつきにより、想定外の干渉や クリアランスが発生することがある。本研究では、3D プリンタの造形物のさらなる高精度化を目的とし、 造形条件が造形物の寸法に及ぼす影響について明らかにし、CAD データの設計値の補正から造形物の寸 法精度を向上させる方法について検討を行った。

キーワード: 3D プリンタ、3D-CAD

Since the performance of the 3D printer has improved, they became commonly used to check the shape of the model and assembly. However, small errors and dimensional variations cause interference and clearance. Therefore, in order to improve the accuracy of modeled objects of 3D printers, we clarified the relationship between molding conditions and dimensions. Furthermore, we verified the method of improving molding accuracy by modifying CAD data.

Keywords : 3D printer, 3D-CAD

#### 1 はじめに

3D プリンタは 3D-CAD ソフト等で作成した 3D モデルデータを入力することで、立体形状 を直接造形することが可能な装置である。工業 製品の試作において機械加工や金型を用いる 従来の手法と比較すると短時間かつ低コスト での試作が可能であり、複雑な形状でも簡単に モデルを得ることが出来る優位性から近年で は様々な企業や業界で利用が進んでいる。

3D プリンタにもいくつかの方式が存在し、 熱可塑性樹脂のフィラメントを熱で溶融して 積層する熱溶解方式や、粉末材料をレーザで焼 結させる粉末焼結方式などが挙げられるが、方 式によって造形可能な材料や大きさ、造形精度、 強度、コスト、造形速度などに特徴があること から、造形物の用途に応じて適切な方式の機種 を選択することが望まれる。

当センターではインクジェット方式の 3D プ リンタを保有している。この方式はヘッドから 噴射した樹脂材料を紫外線で硬化させて積層 を行うものであり、他の方式と比較して積層 ピッチが細かく、高精度な造形が可能である ことが特徴となっている。

しかしながら、造形されたモデルの寸法に は誤差やばらつきが発生し、3D プリンタでは 寸法公差も考慮されないことから、複数の部 品を造形して組み付けを確認する場合には、 造形するモデルや条件によって設計値よりも クリアランスが大きくなる、あるいは部品同 士が干渉してしまう、といった問題が発生す ることもある。

そこで、本研究では 3D プリンタの造形物の 寸法精度の向上を目的とし、モデルに発生す る寸法誤差の傾向を明らかにし、造形条件や モデルの造形方向が造形物の寸法に及ぼす影 響について検証を行った。

さらに、測定値から予想される誤差を考慮 して補正値として反映した 3D データを作成・ 造形することで、3D-CAD データの微小な修正 が 3D プリンタで出力されたモデルの寸法に及 ぼす影響を明らかにし、より高精度な造形物を 得るための手法について検討を行った。

#### 2 方 法

#### 2.1 積層造形

本研究で測定するモデルは当センターが保 有する 3D プリンタ AGILISTA-3100(㈱キーエン ス製)で造形を行う。本装置はインクジェット 方式の 3D プリンタであり、透明色のアクリル 系光硬化性樹脂材料による造形が可能である。

モデルの造形条件は、高さ方向の積層ピッチ を標準条件である20µm、表面仕上げはマット (非光沢)、グロッシー(光沢)の2種類とし た。この表面仕上げの設定によってサポート材 の付着部が変化する。マットではモデルの全面 にサポート材が付着するのに対して、グロッシ ーでは必要な部分にのみサポート材が使用さ れる。サポート材の付着によって、図1のよう に表面状態が変化することから、この変化が造 形物の寸法に及ぼす影響について検証を行う。



図1 表面仕上げ

#### 2.2 モデル形状

測定用のモデルは円形、角形、リング状(円 形および角形)、薄板の5種類を選定し、それ ぞれの形状ごとに寸法の異なるモデルを複数 作成した。モデルの形状と設計寸法は図2に示 す通りである。

モデル形状	寸法[mm]
円形、角形	外径:5,10,20,30,40,50 厚さ:5(共通)
リング状(円形、角形)	(外径,内径):(10,5),(20,10),(30,20), (40,30),(50,40) 厚さ:5(共通)
薄板	厚さ:0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 (高さ,幅):(15,10)(共通)

図2 モデル形状

#### 2.3 試験方法

各モデルをマットとグロッシーの2条件で 造形し、得られた造形物の造形プレート上に おける X 方向、Y 方向の寸法について計測を 行った。なお、1条件あたりの造形サンプル数 は N=3 とした。

CAD データ上の設計値と造形物の寸法の誤 差の平均を算出し、設計値の補正を行った CAD データを作成して STL データを出力した。そ の後、補正後のモデルで再度造形を行い、モデ ルの寸法を計測することで、CAD データの補正 が 3D プリンタでの造形物の寸法に与える影 響について調べた。

#### 3 結 果

#### 3.1 測定結果

造形したモデルの寸法の測定結果をまとめ たものを示す。円形、角形の基本形について は図3、リング状モデルの外径と内径がそれ ぞれ図4と図5、薄板モデルの結果が図6の ようになった。なお、モデルが膨張する方向 の誤差を正としている。

これらの結果から、表面仕上げの設定によ り誤差の傾向が表れており、グロッシーでは モデルが膨張、マットでは収縮する場合が多 く、誤差の大きさはマットがおよそ 0.2mm 以 内、グロッシーがおよそ 0.1mm 以内となって おり、全体的な誤差はグロッシーの方が小さ くなっていることが確認できる。



図3 造形誤差(円形、角形)



図4 造形誤差(リング外径)



図5 造形誤差(リング内径)



さらに、造形の方向に関しては X 方向より も Y 方向の精度が良好であるという結果が得 られた。これは造形する時に 3D プリンタの ヘッドが X 方向に動作することに関係するも のと考えられる。また、薄板形状では厚さ 0.5mmのマットのモデルについては他のモデ ルと比較して誤差の傾向が変化し、寸法が大 きくなる傾向が確認された。

#### 3.2 誤差の分布および補正の効果

補正前の誤差と、補正後の改善の効果をプロットしたものを図7と図8に示す。補正値と補正効果には相関関係が確認でき、補正値と補正効果が一致する線に沿った形で点が密集している。それぞれの条件の相関係数を算出したところ表1のようになった。いずれの条件でも0.8を超える値となり強い相関があることが確認できる。このことからも、CADデータの補正が造形精度の向上にある程度の効果があることがわかる。しかしながら、同じ造形条件のモデルでも寸法や補正効果にばらつきが発生し、補正値以上の変化があったモデルや、補正前よりも誤差が大きくなったモデルも確認された。



図7 寸法補正の効果(マット)



さらに、造形条件ごとの誤差の平均値を図9、 全ての造形物の計測値の誤差分布を条件別に まとめたものを図10に示す。全ての条件で補 正による造形寸法誤差の改善がみられ、このこ とからも CAD の設計値の補正が造形精度の向 上に対して効果があることが確認できる。

しかしながら、誤差の傾向がモデルの大きさ や形状によって変化することに加え、同一のモ デルを複数造形した場合の測定値の最大と最 小の差が 0.1mm 以上になるモデルもあり、寸法 の補正を機械的に行う上ではこれらのばらつ きの発生が問題になると考えられる。



表1 補正値と効果の相関係数

## ' 図9 誤差の平均値

#### 4 まとめ

本研究では 3D プリンタの造形物の造形精 度と造形条件の関係性について調査を行い、 CAD の設計値の補正が造形物の寸法に与える 影響について検証を行った。その結果、以下の ことが確認された。

・表面仕上げの設定によって寸法の傾向に差 がみられた。設計値と比較した場合、マットで は収縮する方向におよそ 0.2mm 以内、グロッ シーでは膨張する方向におよそ 0.1mm 以内の 誤差が生じる場合が多い。

・X 方向と比較して Y 方向の誤差が小さくな る傾向にある。これは、ヘッドやローラーが X 方向に動作することによる影響と考えられる。 ・モデルの形状や造形方向により誤差の傾向 が変化することや、同じモデルを造形しても 寸法にばらつきが発生することから、誤差の 発生を完全にコントロールすることは困難で ある。

・3D-CAD データ補正後の造形物は補正前のものと比較して全体的に寸法精度が向上しており、3D データの補正が造形精度の向上に対して有効であることが示唆された。

表面仕上げ	マット		グロッシー		
方向	X	Y	X	Y	
補正前	50 40 - 30 - 0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 誤差[mm]	50 40- 30- -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 誤差[mm]	50 40- 30- 20- 10- -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 誤差[mm]	-0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 誤差[mm]	
補正後	50 40- 30- 20 10 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 誤差[mm]	50 40 30 -20 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 誤差[mm]	-0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 誤差[mm]	-0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 誤差[mm]	

図10 誤差の分布

## 深さ方向の残留応力分布の測定

荻野直彦·矢澤歩\*

## The measurement of residual stress distribution in depth direction Naohiko OGINO, Ayumu YAZAWA

構造材料の内部には、外見できない形で残留応力が存在しており、機器の損傷では、し ばしばこの残留応力が損傷要因になっている。そのため、いくつかの方法で残留応力の測 定が試みられている。

本研究では、より汎用的な深さ方向の残留応力の測定手法の確立を目的として、鋼材の 深さ方向の残留応力の測定を行い、測定精度についても評価を行った。

キーワード:残留応力測定、穿孔法、ロゼットひずみゲージ、穿孔装置

Residual stress exists inside a structural material as an invisible form, and in the case of equipment damage, this residual stress often becomes a damage factor. Therefore, the measurement of the residual stress has been attempted in several ways.

In this study, we measured the residual stress in the depth direction of steel material for the purpose of establishing more general residual stress measurement method in the depth direction, and also evaluated the measurement accuracy.

Keywords: residual stress measurement, CHD, rosette strain gauge, perforator

#### 1 まえがき

残留応力は、外観からは見えず、認識されることも少ないが、機器の損傷では、度々この残留応力が損傷要因になっていることがある。一般的に、引張の残留応力は悪影響を与え、圧縮の残留応力は疲労強度の向上に良い影響を与えることが多い。そのため、残留応力の正確な測定は、部材ののよが多い。そのため、武留応力の正確な測定は、部材の表面のみならず、部材内部に閉じ込められた残留応力を計測することが部材の評価のために求められている。産業技術センターでも、この残留応力の測定に深くかかわっており、非破壊で残留応力を測定することができる X 線応力測定装置を使用し、実績を上げている。

ただし、産業技術センターの保有する X線残留応力測定装置では、最大で十数 µmの厚さ方向の平均値しか測定できず、 内部の深さ方向の測定をすることができて いない。そこで、部材内部の深さ方向の残 留応力測定について、より汎用的な手法に より実用に耐えうる測定精度を持った測定 手法の確立を目指した。

構造材料内の残留応力を測定する方法に はいくつかの種類があり、測定サンプルの 破壊の程度によって、非破壊法 (noninvasive)、部分破壊法 (semiinvasive)、完全破壊法 (totally destructive) に分類されている。

非破壊法は、X 線回折法(X-ray)、中 性子回折法(Neutrons)、超音波法 (Ultrasonic) などがあるが、いずれも 表面近傍の測定のみに適応され、深さ方向 を測定するためには、電解研磨などにより 部分的な破壊を用いなければならない。ま た、通常の X 線では、測定深さは鋼材の 数十 µm 程度である。 部分破壊法と完全破壊法は、部材の切断 破壊により解放されるひずみを測定するこ とで応力に換算するものである。部分破壊 法の中に、部材をドリルで穿孔する穿孔法 がある。穿孔法は 2 ~ 4mm の深さまで 測定可能とされている。



図1 穿孔法<sup>1)</sup>

穿孔法の測定手順は、ASTM 規格 E837-08<sup>2)</sup> に規定されている。

ASTM 規格によると穿孔装置は、測定 対象に応力影響を与えない手法によること とされている。関連文献に多く用いられて いる手法は、エアタービンドリルを用いて 穿孔しているものが多い。<sup>3)4)</sup> そもそも このような装置自体の入手が難しく本測定 手法が敬遠されている原因となっている。

本研究では、より汎用的な測定を目指し て、ASTM 規格とその他の穿孔法関連文 献を参照して、部分破壊法に属する穿孔法 について汎用フライスを用いて応力測定を 行い、精度についての検証を行う。さらに 電解研磨法により表面を研磨し、X線残留 応力測定装置で残留応力を測定し、穿孔法 による測定値との比較評価を行うこととす る。

#### 2 実験方法

#### 2.1 使用機器

今回の測定では、ASTM 規格などによるエアタービンドリルなどの穿孔装置ではなく、より一般的な装置である必要がる。 そのため、より一般的な汎用フライス(図 2)を用いての測定行うこととした。Ζ 軸 方向の分解能は、3μm である。



図 2 穿孔装置 (汎用フライス)

実際の測定は、図 3 に示すように穴の 周囲に配置された特殊なロゼットひずみゲ ージにより、穿孔にともなう半径方向の部 分解放ひずみを 3 箇所で測定した。



**X** 線残留応力測定は、リガク MSF-2M を 使用した。

#### 2.2 残留応力の負荷

今回の測定の目的は、測定した残留応力 値の正しさを検証することにある。そのた めに、部材の深さ方向に対して既知の応力 を負荷する必要がある。部材内部に均一勾 配の応力値を負荷するため、今回の測定で は、4 点曲げ冶具(図 4)を用いて、仮想 の残留応力を負荷した。負荷された深さ方 向の応力分布を穿孔法及び電解研磨+X 線 応力測定により測定した。4 点曲げでの応 力分布は、図 5 のように上下一次関数の ような分布となる。そのため、負荷した曲 げ応力を裏面にある歪みゲージにより測定 することで表面からの深さ方向の残留応力 を予測できる。予測した応力値を正として、 実際にそれぞれの手法により測定した残留 応力値と予測値を比較して測定精度の検証 を行った。



図4 4 点曲げ装置



図 5 断面応力分布

#### 2.3 測定サンプル

今回測定したサンプル(図 6)は、材質 SS400として、サンプル形状は、 サンプル:幅 32.1mm、厚さ 4.3mm

とした。



図 6 サンプル

#### 2. 4 穿孔法による残留応力の解析

今回の測定では、破壊する穿孔の大きさ は φ2mm、穿孔深さはサンプル板厚の 1/2 までとした(圧縮残留応力と引張残留応力 が逆転する点まで穿孔した)。残留応力測 定専用の歪みゲージを測定部位に接着し、 その中心に穿孔し、それにより発生する部 分開放ひずみ、穿孔直径寸法、試験体の弾 性係数、ポアソン比などを用いて残留応力 を解析した。

穿孔法の基礎となる原理は、Mathar が 最初に提案したものである。<sup>6)</sup>残留応力 を有する物体に穴をあけると、その位置で 応力が解放されて穴近傍の応力分布が変化 する。G.Kirsch は、均一残留応力を受け ている薄板に、小さな貫通穴をあけた状態 のケースにおける解を得ている。<sup>7)</sup>

穿孔法は、均一な平面応力を受ける薄肉 の幅広平板を貫通して穿孔された小孔を前 提として開発されたが、通常の機械部品や 構造部材は、大きさ、形状とも様々であり、 実際の使用条件からは、かけ離れたもので あった。多くのケースでは、測定対象物は 厚肉であり、穿孔穴は、浅い"ブラインド" 穴を用いることが必要となる。

平面応力場にブラインド穴を穿孔すると、 非常に複雑な局所応力状態を生じ、正確な 解を弾性理論から求めることは大変困難と なってしまう。しかし、Rendler と Vigness<sup>8)</sup> によって、ブラインド穴の応 力分布の性質が貫通穴の場合と非常に類似 することが実証されている。ブラインド穴 を穿孔することによって解放されるひずみ を測定することで、開放された応力を解析 することができる。ブラインド穴を穿孔す ることによる解放ひずみ er は、穴と同心 の円弧に沿って sin 関数的に変化し、穿 孔深さに対応する開放された応力の和とな る。

実験的な検証から得られた適切なブライ ンド穴係数を用いれば、より高い精度でブ ラインド穴にも適用できるが、今回の研究 では、穴係数は、G.Kirsch によって与え られた式から得られた式(1)を用いて、解 析された応力値の検証を行った。<sup>5)</sup>

$$\sigma_{\max} = \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_3}{4A} + \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_3}{4B\cos 2\theta} \qquad \cdots (1)$$

$$4A = \frac{(1+\nu)d2}{2ER2}, \ 4B = \frac{2d2}{ER2} + \frac{3(1+\nu)d4}{8ER4}$$

v:ポアソン比 R:ゲージ中心半径
 d:穿孔径 E:ヤング率

#### 3. 結果および考察

#### 3.1 穿孔法による測定

サンプル裏面に貼付けした歪みゲージの 値から計算した最表面の応力値を負荷応力 値とし、そこから厚さ中心点がゼロとなる 勾配で予測値とした。

①負荷応力 120MPa

表面負荷応力 120MPa 時の応力分布測 定結果を図 7 に示す。測定値の線形性は 0.7564 となり、ばらつきが多い。1mm 過 ぎから、予測値と乖離が大きくなっている ことが原因と考えられる。



図7 応力-深さ(120MPa,穿孔法)

そこで、図7を1mm までの測定にして 再度解析したものを図8に示す。 線形 性は、 0.9651 となり、バラツキも抑え られ、予測値との傾きも近いと考えられる。



#### ②負荷応力 300MPa

表面負荷応力 300MPa 時の応力分布測 定結果を図 9 に示す。①の結果と同様な 傾向がある。1mm を超えると応力が平準 化してしまっている。つまり、解放される ひずみの測定ができていないか、穿孔によ り応力分布が変化し、解放される歪みが極 端に減少している恐れがある。



図 9 応力-深さ(300MPa,穿孔法)

そこで、図9を1mm までの測定にして 再度解析したものを図10に示す。1mm までの測定に限定すると、線形性は 0.9496となり、バラツキも抑えられ、予 測値との傾きも近いと考えられる。



3.2 電解研磨法+X線測定

#### ①負荷応力 124MPa

表面負荷応力 124MPa 時の応力分布測 定結果を図 11 に示す。電解研磨面積は、 15mm×15mm とした。穿孔法の穿孔径に 比べ、研磨面積が大きいため、表面応力へ の影響を考慮してごく表層のみの測定とし た。予測値に対して近い測定ができている。



 3 測定値と予測値の差異について 穿孔法における測定値と予測値との差異 は、ASTM 規格 E837-08 では、最大深さ を Z/D = 0.4 (Z;深さ、D;穿孔径)と 規定しており、今回の穿孔径 2mm では、 深さが 1mm 以上となると、感度が低下し たと考えられる。

1mm までの測定精度に関しても、今回 解析に用いた係数は、薄板と同じものであ ったが、より測定精度あげるためには見直 す必要がある。物性データについても、一 般的な数値を用いたが、実験により物性値 を取得していく必要がある。そのため、今 後データ数を増やし再現性をあげて行くこ とで実用レベルに近づける必要がある。

電解研磨法+X線測定における測定値と 予測値との差異は、測定精度を上げるため、 研磨面積を確保する必要があり、応力分布 に与える影響が大きく、測定値精度が低下 する要因になると考えられる。電解研磨法 は、表面影響を除去する目的での利用に適 しているといえる。

#### 4. まとめ

①汎用フライスを使用した穿孔法では、 1mm 程度の深さまでは、予測値に対して フィッティングのよい測定を行えた。ただ し、より測定精度を上げるためには、係数 等の見直しが必要といえる。

②穿孔法は、部分破壊を伴うため、穿孔による応力の変動があり、穿孔後の相対的な断面積の減少影響が大きい薄物や、応力が過剰に大きいものの場合には注意が必要となる。

③今回使用した X 線残留応力測定装置では、 電解研磨すると応力分布に与える影響が大 きく、深さ方向の分布を測定するのには適 していない。

#### 文献

1) Technical Note TN-503-6,

"Measurement of Residual Stresses by the Hole-Drilling Strain-Gauge Method",Vishay Measurement Group, 2010

2) ASTM E 837-08, "Standard Test Method for Determining Residual Stresses by the Hole-Drilling Strain-Gauge Method", 2008

 3) 三上隆男: "穿孔法による残留応力測測 定について(その 1)" IIC REVIEW No.48

4) Kabiri, M., "Measurement of Residual Stresses by the Hole-Drilling Method:Influences of Transverse Sensitivity of the Gage and Relieved Strain Coefficients", Experimental Mechanics 25, 1984

5)株式会社東京測器研究所 2015-2016 「製品総合カタログ」P87

- Mathar, J., "Determination of Initial Stressesby Measuring the
- Deformation Around DrilledHoles",
  - Trans., ASME 56, No.4, 1934

7) Timoshenko, S. and J. M. Goodier, "Theory ofElasticity", New York: McGraw-Hill, 1951

8) Rendler, N. J. and I. Vigness, "Hole-drilling Straingage Method of Measuring Residual Stresses",Proc.,

SESA, XXIII, No.2, 1966

## 引張試験における画像処理を用いたひずみ測定手法の開発

新井宏章·荻野直彦\*·岩沢知幸\*·鏑木哲志\*\*

## Development of Strain Measurement Method using Image Processing in a Tensile Test Hiroaki ARAI, Naohiko OGINO, Tomoyuki IWASAWA and Tetsushi KABURAGI

本研究では、引張試験における伸びを測定する手法として、安価な高速度カメラと汎用的な画像処 理を用いて低価格帯のビデオ伸び計を提案する。PLC(プログラマブルロジックコントローラ)を用 いて記録計と高速度カメラに同期信号を出力し、記録計は万能試験機の荷重を記録し、高速度カメラ は画像を記録する。画像処理プログラムを用いて、記録した画像から伸びを測定する知見を得た。

キーワード:引張試験、ビデオ伸び計、高速度カメラ、画像処理

In this research, we propose low cost price video extensometer using inexpensive high-speed camera and general purpose image processing as a method of measuring elongation in tensile test. A synchronous signal is output to the recorder and the high-speed camera using a PLC (Programmable Logic Controller), the recorder records the load of the tension testing machines, and the high-speed camera records the image. We obtained findings to measure the elongation from the images recorded using image processing program.

Keywords : Tensile Test, Video Strain, High-Speed Camera, Image Processing

#### 1 まえがき

万能試験機は引張試験や圧縮試験などを行 うことができ、試験機が負荷した力と加えられ た力による試験体の変形量の関係により、変形 のしにくさや壊れにくさの指標になる弾性係 数や強さなどの物性値を算出する際に用いら れる。試験を行う際には、試験体を試験機で固 定する必要があり、試験体の変形量を試験機の 変位量とみなして、変形量の測定を省略すると きがある。しかし、固定する力が弱い場合、試 験体と固定した面がすべることで、試験機の変 位量を用いて物性値を算出すると物性値は真 の値と大きく異なってしまう。従って、より正 確な物性値が求める為には、試験前にポンチや けがき線などのマーキングした 2 点間の距離 (標点間距離)を計測することが必要不可欠で ある。実際に、センターを利用する企業から、 伸びを計測する装置を用いて試験を行いたい という要望がある。

伸びを計測する方法の一つにビデオ伸び計を 用いた手法がある。ビデオ伸び計とは、ビデオカ メラを用いて試験片を撮影し、映像から標点を 検出することで標点間の伸びを測定する手法で ある。この測定手法の長所は設置が容易である こと、非接触であるため試験片に影響を与えな いこと及び機構が単純であることが挙げられる。

本研究では、安価な高速度カメラと画像処理 技術を用いて、センターが所有している従来の ビデオ伸び計と同水準以上のビデオ伸び計のシ ステムが開発できる可能性を検討することを目 的とする。

#### 2 実験方法

#### 2.1 万能試験機

引張試験で使用する機器は当センターが保有 する図 1 に示すインストロン社製、万能試験機 「材料試験システム」である。荷重容量は 100kN である。



図1 材料試験システムの外観

#### 2.2 試験片

本研究では JIS Z2241 に規定される 13A 号を使用した。

#### 2.3 試験方法

#### 2.3.1 静的な伸びの測定

試験機(クロスヘッド)の変位が 1mm になる まで、0.1mm ずつ負荷した後、万能試験機を 停止し、静的な伸びを測定した。

伸びの測定には、開発した高速度カメラを用 いたビデオ伸び計とインストロン社製ビデオ 伸び計を用いる。ビデオ伸び計を用いた測定と 同時に、高速度カメラ(UI-3180CP-C-HQ Rev.2、IDS 社製)で画像を取得し、その画像 から標点間距離の測定を行った。試験を行って いるときの様子を図 2 に示す。ビデオ伸び計 の横にカメラを設置した。

画像処理ソフトウェア(Future Processing 社製 Adaptive Vision Studio)により作成した プログラムを用いて、取得した画像から標点間 距離の測定を行う。標点間距離を測定するため に作成したフローチャートを図3に示す。



図2 静的な伸びの測定



図3 静的な伸び測定フローチャート

#### 2.3.2 動的なひずみの測定

2.3.1 で使用した装置を用いて連続的に画像 を取得し、ひずみを測定した。

取得したひずみを比較するために、ひずみゲ ージ(FLA-3-11、記録計にキーエンス社製NR600、 NR-ST04 を使用)及びビデオ伸び計(インストロ ン社製)を用いてひずみを測定する。

ひずみ測定フローチャートを図 4 に示す。試験開始とともに、プログラマブルコントローラ (FX5UC-32MT/D、㈱三菱電機製)から記録計と カメラに同期信号を出力する。同期信号が入力 された記録計は万能試験機からアナログ電圧 として出力されている荷重及びひずみゲージ からひずみを取得し、カメラは画像を取得する。 画像処理により、取得した画像から標点間距離 を測定する。

ビデオ伸び計は 1 秒ごとに独立で、ひずみ を測定する。



## 図 4 動的なひずみ測定フローチャート

#### 3 実験結果

#### 3.1 静的な伸びの測定結果

ビデオ伸び計を用いて測定した伸びと高速 度カメラを用いて測定した伸びを図5に示す。 相関係数が0.995であることから、強い相関が ある。



## 図 5 ビデオ伸び計及び高速度カメラによる伸 びの測定

#### 3.2 動的な伸びの測定結果

ビデオ伸び計、高速度カメラ及びひずみゲー ジを用いて測定したひずみの時間変化を図 6 に 示す。ひずみゲージの測定結果は、測定範囲が小 さいため、波形が途切れている。

応力一ひずみ曲線を図 7 に示す。ひずみが大 きくなると、ひずみゲージとビデオ伸び計によ る測定結果と高速度カメラによる測定結果の値 が異なった。



![](_page_33_Figure_0.jpeg)

4 まとめ

当センターにおいて、高速度カメラと画像処 理技術を用いた伸び計の開発を行った結果、次 の知見を得た。

 高速度カメラと画像処理技術を用いて 標点間距離の測定ができることが分かった。

(2)レンズの校正を行っていないため、測定 精度に影響を与えたことが考えられる。

引き続き、レンズの校正などの調査を行い、 測定精度向上、検証及びシステムの構築を行う。

## 検査システムの開発に関する研究

新井宏章·小宅勝\*·鏑木哲志\*\*

## Research on Development of Inspection System Hiroaki ARAI, Masaru OYAKE\* and Tetsushi KABURAGI\*\*

本研究では、画像処理を用いて、不具合を発生させる原因の一つである工具の損傷の評価を行うシ ステムの構築を行った。また、暗室内で測定することで、実際の加工機内での測定条件に近づけて測 定を行った。その結果、暗室内でも同様の測定結果が得られたことから、加工機内でも測定できるで あろうという知見を得た。

キーワード:切削工具、画像処理、暗室

In this research, we have constructed an image processing system that evaluates tool damage, which is one of the reasons for producing inferior goods. In addition, by measuring in the darkroom, measurements were made close to the measurement conditions in the actual processing machine. As a result, similar measurement results were obtained even in the darkroom, so we obtained the finding that it could be measured even in the processing machine.

Keywords : Tools, Image Processing, Darkroom

#### まえがき 1

不具合品を市場に流出しないためには、不具 合を発生させないこと及び検査を行い、不具合 品を取り除くことが必要不可欠である。現在、 中小企業においても加工のばらつきを削減す るために、材料の製造装置への供給や加工は自 動化が進んでおり、不具合の発生を少なくする 取り組みを行っている。一方で、検査は人手に 頼っていることが多く、人的誤差により、不具 合品を完全に取り除くことはできない。加えて、 人手に頼ることで、製造期間の短縮や人件費の 削減は難しい。さらに、製品不良が発生してし まった場合は迅速な対応が求められ、多くの人 を雇わなければならない。その状況を打開する ために、初期投資で済む市販されている自動検 査システムの購入を検討している中小企業が 多いが、価格が高いため導入を断念している企<br />
に分類し、刃先の損傷を計測する。 業もある。

従って、企業に広く利用される技術を群馬産 業技術センターで確立するために、例として画

像処理を用いて、不具合を発生させる原因の一 つである工具の摩耗の評価を行うシステムの構 築を行う。

本研究では、画像処理による切削工具の損傷 の測定において、外乱光が測定に及ぼす影響を 調査することを目的とし、加工機内での刃先の 損傷の測定に応用する。

#### 2 実験方法

#### 2.1 切削工具

本研究では図1に示す刃先角度80度の切削工 具を用いる。切削工具の損傷形態は図 2 のよう に7つに分類されるが、切削加工を行った後の 64 個の工具を観察したところ、逃げ面摩耗が発 生していた。従って、本研究では切削工具の損傷 を目視で評価し、水準を図3に示すように4つ

![](_page_35_Figure_0.jpeg)

### 2.2 損傷度合の測定

量的評価

摩耗量を測定するために、図 4 に示す画像 測定機(ミツトヨ製 QVM3-H606)で各工具の 3180CP-C-HQ Rev.2(IDS 社製)を使用した。 形状を測定する。測定結果より検査ソフトウェ ア (GOM 社製 GOM Inspect)を用いて、損傷 り、摩耗量をカラーマップで表現する。

![](_page_35_Picture_4.jpeg)

図4 画像測定機の外観

#### 2.2.2 外乱光の影響の調査

加工機内の明度は、暗室内より明るく、蛍光 灯が点灯した室内より暗いことが想定される。 蛍光灯などの外乱光が測定に及ぼす影響を調 査するために、リング照明と蛍光灯が点灯して

いる室内及びリング照明のみが点灯している暗 2.2.1 画像測定機を用いた摩耗量の定 室内で撮影を行う。撮影した画像を画像処理に より、摩耗量の評価を行い、比較する。暗室内で 撮影している様子を図 5 に示す。カメラは UI-

刃先の損傷を測定するフローチャートを図 6 に示す。 画像処理ソフトウェア (Future の無い切削工具と各損傷した工具の差分を取 Processing 社製 Adaptive Vision Studio)を用い て評価プログラムを作成した。刃先の損傷が大 きくなるほど、検出領域が大きくなるように二 値化の閾値を設定した。

![](_page_35_Picture_10.jpeg)

図5 暗室での撮影

![](_page_36_Figure_0.jpeg)

3 実験結果

#### 3.1 画像測定機を用いた測定結果

画像測定機を用いた摩耗量の測定結果を示 す。画像測定機を用いた損傷の無い切削工具の 測定結果を図7に示す。損傷の無い切削工具 と各損傷した工具の差分した結果を図8、図9、 図10に示す。図8、図9、図10の画像より、 減った面積を測定した結果を図11に示す。目 視での評価と同じ等級付けになった。

![](_page_36_Figure_4.jpeg)

![](_page_36_Figure_5.jpeg)

![](_page_37_Figure_0.jpeg)

図 10 損傷無と損傷大の差分

![](_page_37_Figure_2.jpeg)

## 3.2 暗室を用いた測定

測定を行った画像を図 12、図 13、図 14、図 15 に示し、検出面積を図 16 に示す。図 16 中 の破線は損傷無しの検出領域である。暗室内で 測定すると、刃先の損傷が小程度及び中程度の 切削工具は検出領域が大きくなり、刃先の損傷 が大きい切削工具は検出領域が小さくなった。

![](_page_37_Picture_5.jpeg)

(a) 室内(b) 暗室内図 12 損傷無の検出結果

![](_page_37_Picture_7.jpeg)

(a)室内(b)暗室内図 13 損傷小の検出結果

![](_page_37_Picture_9.jpeg)

(a) 室内 (b) 暗室内 図 14 損傷中の検出結果

![](_page_37_Picture_11.jpeg)

(a)室内(b)暗室内図 15 損傷大の検出結果

![](_page_37_Figure_13.jpeg)

#### 4 まとめ

本研究では、画像処理による切削工具の刃先 の損傷の測定において、外乱光が測定に及ぼす 影響を調査することを目的とし、暗室内で4つ の切削工具の損傷度合の測定を行った結果、次 の知見を得た。

- (1)作成したプログラムで、リング照明と蛍 光灯が点灯している室内及びリング照明 のみが点灯している暗室内で切削工具の 刃先の損傷度合を測定した結果について、 画像測定機と同じ等級付けになった。
- (2)加工機内の明るさは、暗室より明るく、蛍 光灯が点灯した室内より暗いため、同じ条 件であれば、加工機内でも切削工具の損傷 の度合を測定できる。

引き続き、平成 29 年度研究開発推進費で、 センターで企業に広く利用される技術を確立 することを目指す。

## 毛髪混入異物の加熱履歴に関する研究

梅澤悠介・五十嵐昭\*

## Study on heat history of hair in foods Yusuke UMEZAWA • Akira IGARASHI\*

食品中に混入した毛髪の加熱履歴を特定する手法について、走査型電子顕微鏡、赤外分 光分析装置、示差走査熱量分析装置を用いて検討した。市販の毛髪を炊飯器で白米と一緒 に炊飯した検体、コロッケと一緒に油で揚げた検体およびボイルした検体を準備し、熱を 加えていない検体と比較した。その結果、電子顕微鏡による表面観察では、油で揚げた検 体で部分的に膨らみが観察された。示差走査熱量分析装置による測定では、熱を加えてい ない検体では 170℃付近に明確な吸熱ピークが観察できたが、炊飯した検体、油で揚げた 検体では吸熱ピークの大きさ、有無に違いが確認できた。これらの結果から、毛髪異物の 加熱履歴を特定できる可能性が示唆された。

キーワード:毛髪、加熱履歴、示差走査熱量分析

The analysis method for heat history of hair in foods was examined by using Scanning electron microscope, Fourier transform infrared spectroscopy and Differential scanning calorimetry. Hair specimens having heat history were prepared by boiled with rice, fried with potato croquettes, and cooked in boiling water. A bulge was observed by means of SEM, when the hair specimen fried using edible oil and potato. Upon using hair specimen without heating, the peak around  $170^{\circ}$ C assigned to endothermic was clearly recognized by means of DSC. In contrast to these, upon measuring hair specimens having various heat histories, DSC peaks shape and these appeared temperatures were changed and shifted from those of non-treated hair.

Keywords : hair, heat history, differential scanning calorimetry

#### 1. はじめに

近年、食品の原材料偽装や、農薬混入などの問題により、食品に対する消費者の安全意識が高まっている。とりわけ食品の異物混入に対する関心は高く、当センターへの問い合わせや分析依頼も増加している。食品混入異物は、植物片、カビなどの微生物、毛髪、虫、動物組織、プラスチック、金属片など様々であるが、中でも毛髪異物の分析に関して、当センターへの分析依頼は増加しており、H26年度からH27年度にかけて約4倍に増加した。 毛髪混入の要因としては、製造現場の作業 者由来のもの、原料動物由来のもの、作業用 品由来のものなど様々な可能性がある。また、 開封後の商品であれば、ペット由来など消費 者サイドで混入した可能性もある。そのため 毛髪が混入した原因を特定するためには、混 入した毛髪の種類や加熱履歴の特定すること が必要になる。多くの食品は加熱処理して製 造されるため、加熱履歴が明らかになれば混 入経路の特定に繋がる可能性がある。

現在、当センターでは、毛髪異物の分析依 頼があった場合、スンプ法(表面観察法)によ り、毛髪異物の表面の型を取ることでキュー ティクルの形状から毛髪の種類の特定を行っ

ている。加熱履歴を特定する分析は行ってい ないが、明らかにすることが出来れば、毛髪 が製造者サイドで混入したのか、消費者サイ ドで混入したのか判断する材料のひとつにな り、大変有益である。

そこで本研究では、毛髪の加熱履歴を特定 する手法の確立を目的として分析を行った。

#### 試験方法 2.

#### 2.1 試料及び熱処理条件

毛髪サンプルとして、人毛毛束【黒毛】(毛 束屋)を使用した。購入した毛髪は、40℃に設 定した恒温器内で一晩乾燥または水中で一晩 浸水させた。乾燥または浸水させた毛髪は、 白米と一緒に炊飯または冷凍コロッケの表面 に入れて油中で約20分間加熱を行った。ま た、購入した毛髪を約10分間水中で加熱した ものと、熱を加えていない毛髪(購入品そのま ま)を合わせて8種類の検体を準備した。

#### 2. 2 分析条件

分析には、日本電子株式会社製走査型電子 顕微鏡(JSM-5600LV)(以下、SEM)、Thermo Fisher Scientific 社製赤外分光分析装置(フー リエ変換赤外分光分析装置 iS50 +赤外顕微 鏡 Continuµm)(以下、FT-IR)、PerkinElmer 社 製熱分析システム(DSC8000)(以下、DSC)を使用 した。

SEM は、加速電圧 10kV で測定を行い、毛髪 の表面形状を観察した。

FT-IR は、顕微 ATR 法により行い、毛髪の 表面及び内部を分析した。ATR 媒質にはゲル マニウムを用い、波数分解能 8cm<sup>-1</sup> で測定を 行った。得られた ATR スペクトルを吸光度で 表示し、赤外光潜り込み深さを考慮した ATR 補正を施した。

DSC は、パージガスとして窒素を使用し、 昇温速度は 1.00℃/分で、-30℃から 180℃ま での温度範囲を測定した。

#### З. 結果及び考察

#### 3.1 SEM による表面観察結果

図1にSEMにより毛髪の表面を観察した結

果を示す。熱を加えていない検体(購入品、乾 燥、浸水)、炊飯及び水中で加熱した検体では、 人毛に特徴的に見られる横行波状の小皮紋理 (キューティクル)が観察され、熱を加えてい ない検体との差は確認できなかった。しかし 油中で加熱した検体では、部分的ではあるが 横行波状のキューティクルが観察されず、表 面に膨らみが観察された。これは、毛髪を油 で加熱したことによって、毛髪表面にダメー

![](_page_40_Figure_14.jpeg)

![](_page_40_Picture_15.jpeg)

![](_page_40_Picture_16.jpeg)

(g)

![](_page_40_Picture_17.jpeg)

![](_page_40_Picture_18.jpeg)

![](_page_40_Picture_19.jpeg)

(a)購入品	(b)乾燥
(c)浸水	(d)乾燥後炊飯
(e)浸水後炊飯	(f)乾燥後油中で加熱
(g)浸水後油中で加熱	(h)水中加熱

図1 SEM による表面観察結果

ジが加わり、キューティクルの構造が変化し たためと推察される。また観察された膨らみ は、熱が加わったことにより、毛髪の内部の 空気が膨張したためと推察される。

#### 3. 2 FT-IR による構造分析

図 2 及び図 3 に毛髪の表面及び内部を FT-IR を用いて測定した結果を示す。毛髪の 表面からは、タンパク質などのペプチド結合 を有する化合物に特徴的な赤外線スペクトル (3285cm<sup>-1</sup>付近、1645cm<sup>-1</sup>付近、1530cm<sup>-1</sup>付近)、 水酸基に特徴的な赤外線スペクトル (3285cm<sup>-1</sup>付近)が検出された。1645cm-1付近 のピークはペプチド結合における C=0 の伸縮 振動でアミド1バンドと呼ばれている。この アミド1バンドは、タンパク質の二次構造に よりピークの位置や形状が異なることが知ら れている。今回の測定では、熱を加えていな い検体(購入品、乾燥、浸水)と熱を加えた検 体(炊飯、油中で加熱、水中で加熱)で明確な 差は見られなかった。

また、毛髪の内部においても、タンパク質 などのペプチド結合を有する化合物に特徴的 な赤外線スペクトル(3285cm<sup>-1</sup>付近、1645cm<sup>-1</sup> 付近、1530cm<sup>-1</sup>付近)、水酸基に特徴的な赤外 線スペクトル(3285cm<sup>-1</sup>付近)が検出されたが、 熱を加えていない検体(購入品、乾燥、浸水) と熱を加えた検体(炊飯、油中で加熱、水中で 加熱)で明確な差は見られなかった。

![](_page_41_Figure_4.jpeg)

![](_page_41_Figure_5.jpeg)

![](_page_41_Figure_6.jpeg)

(a) 賄 <b>人</b> 品	(D)乾燥
(c)浸水	(d)乾燥後炊飯
(e)浸水後炊飯	(f)乾燥後油中で加熱
(g)浸水後油中で加熱	(h)水中加熱
図 3 FT-IR による	る毛髪の内部分析結果

#### 3. 3 DSC による相転移現象の測定

図4に各検体のDSC曲線を示す。熱を加え ていない検体(乾燥及び浸水)では、170℃付近 に明瞭な吸熱ピークが確認できた。炊飯した 検体(乾燥及び浸水)では、170℃付近に吸熱ピ ークが確認できたが、熱を加えていない検体 に比べ、小さなピークであった。油中で加熱 した検体(乾燥及び浸水)では、170℃付近にピ ークは確認できなかった。これは、毛髪に熱 が加わったことにより、タンパク質の熱変性 が起こり、構造が変化したためと推察される。

![](_page_42_Figure_2.jpeg)

(c)乾燥後炊飯	(d)浸水後炊飯
(e)乾燥後油中で加熱	(f)浸水後油中で加熱

#### 図 4 DSC 曲線

以上の結果から、毛髪の加熱履歴が DSC を 用いて確認できる可能性が示唆された。

#### 4. まとめ

- 1.当センターにおける毛髪混入異物の加熱 履歴を特定する手法の確立ために、SEM、 FT-IR、DSC を用いて検討した。本研究に おける分析対象としては、市販の人毛とし た。
- 2. SEM での表面観察では、炊飯した検体、水 中で加熱した検体と熱を加えていない検 体との間に明確な差は確認できなかっ た。しかし、油中で加熱した検体では、 部分的にキューティクルが観察されず、 表面の膨らみが確認された。油中で加熱 したものであれば、表面を観察すること

により、加熱履歴を特定できる可能性が 示唆された。

- 3.FT-IR での分析では、表面及び内部の構造 を測定したところ、熱を加えていない検 体と熱を加えた検体(炊飯、油中で加熱、 水中で加熱)との間に明確な差は確認で きなかった。
- 4.DSC での分析で、170℃付近に観測される 吸熱ピークに差が見られ、炊飯した検体で は吸熱ピークが小さくなり、油中で加熱し た検体では吸熱ピークが確認できなかっ た。170℃付近に見られる吸熱ピークの大 きさ、有無から加熱履歴を特定できる可能 性が示唆された。

#### 文 献

1) 佐藤元、混入毛髮鑑別法

## 金属ーガスーポリマー接触界面での新しいタイプの

## 成形不具合に関する解析技術の開発

熊澤直人·恩田紘樹\*·和田智史\*·鈴木 崇\*\*

# The development in analysis method of molding defect enhanced on metal-gas-polymer surface Naoto KUMAZAWA, Kouki ONDA, Satoshi WADA, and Takashi SUZUKI

シリカ担持 Fe 試料 (Fe/SiO<sub>2</sub>) 及び Ni 試料 (Ni/SiO<sub>2</sub>) とポリブチレンテレフタレート (PBT) を 260°C、 280°C及び 300°Cで接触させた結果、PBT 単独の場合と比較して PBT からの水素引抜き及び主鎖切断に よる C<sub>1</sub>~C<sub>4</sub>炭化水素の生成が促進され、また、実成形温度域である 260°Cから 280°Cにかけては水素引 抜きが優先的に起きた。さらに、PBT の主鎖切断により生成すると考えられる dibut-3-enyl terephthalate 量も、280°Cで Fe/SiO<sub>2</sub>、Ni/SiO<sub>2</sub>と接触させたとき 1.9 倍および 1.8 倍に増加した。このように PBT 残さ 表面物質で主鎖骨格を含む低分子量物質が確認されたことから、Fe や Ni との接触界面で PBT の主鎖切 断が促進されたことが示唆された。

キーワード: PBT、金属による分解促進、ニッケル、鉄、触媒

When poly(butylene terephthalate)(PBT) was contacted with Fe/SiO<sub>2</sub> and Ni/SiO<sub>2</sub> specimens at 260 °C, 280 °C and 300 °C, generation of hydrogen and light hydrocarbons like  $C_1 \sim C_4$  was promoted relative to the case in the absence of these silica supported metal specimens. Particularly, generation of hydrogen was preferentially recognized on these specimens around 260 °C ~ 280 °C. Upon contacting PBT with Fe/SiO<sub>2</sub> and Ni/SiO<sub>2</sub> specimens, dibut-3-enyl terephthalate caused by scission of PBT chain was increased 1.8 ~ 1.9 fold as much as that in the case using PBT alone. It was inferred from these results that scission of PBT chain was activated on the surface of Fe and Ni.

Keywords : PBT, metal assisted decomposition, nickel, iron, catalyst

#### 1 緒 言

国内のプラスチック成形加工現場では、 様々な製品の微細化や複雑形状化により、ガ ス焼けが起こりやすくなっている<sup>1)</sup>。一般的 にガス焼けは、断熱圧縮やせん断発熱に伴う 樹脂の燃焼により引き起こされると考えられ てきた<sup>2-4)</sup>。一方、これまでに我々は Fe や Ni といった金属種とポリブチレンテレフタレー ト(PBT)の接触界面において PBT の分解が 促進され、燃焼によらない新しいタイプの変 色が起こることを報告してきた<sup>5,6)</sup>。本報で は金属と接触させた PBT 表面より生成した ガスや残さ表面物質を分析し、金属-ガス-樹 脂の接触界面で起こる PBT の分解挙動につい て樹脂の化学的変化の観点から検証した。

#### 2 実 験

#### 2.1 高分散型金属試料の調製

シリカ(SiO<sub>2</sub>、Silica Gel60、比表面積410m<sup>2</sup>/g、 Merck 製)を電気炉(FO-300、ヤマト科学製) で 500℃で 2 時間焼成した。仕上がりの試料重 量基準で Fe が 10wt%含有されるよう、硝酸鉄 (Ⅲ)九水和物(Fe(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>・9H<sub>2</sub>O、試薬特級、 和光純薬製)をイオン交換水に溶解させた。こ れにイオン交換水を加え、飽和吸水量の約 1.2 倍容の硝酸鉄水溶液を調製した。この水溶液を 予め焼成した所定量のSiO<sub>2</sub>に含浸して1時間 静置し、得られたスラリーをロータリーエバ ポレーターに移して 50℃に加温しながらア スピレーターで減圧乾燥した。その後、石英 製炉心管に移して横型管状電気炉(KTF-30N、 光洋製)で空気を約 200ml/min で通気しなが ら 500℃で 2 時間焼成し、SiO<sub>2</sub> 担持 Fe 試料 (Fe/SiO<sub>2</sub>)の前駆体を得た。SiO<sub>2</sub> 担持 Ni 試 料(Ni/SiO<sub>2</sub>)の前駆体の調製には、出発物質 に硝酸ニッケル六水和物(Ni(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>・6H<sub>2</sub>O、 試薬特級、和光純薬製)を用い、Fe/SiO<sub>2</sub>と同 様の手順で調製した。

#### 2.2 PBT の接触分解実験

図1に、接触分解実験に用いた閉鎖循環系 反応装置を示す。ポリブチレンテレフタレー ト(PBT) (#2000-ジュネラルミックスナチ ュラル、日本ポリプロ製)0.5gを精秤し、ガ ラス製ベッセルの枝管部分に充填した。次に 反応装置の反応床に高分散型金属試料前駆体

![](_page_44_Figure_3.jpeg)

図1 閉鎖循環系反応装置の模式図

を 0.05g 充填して 500℃に昇温後、水素を系内 に 33.3kPa となるように導入し、1 時間還元し た。真空下で室温まで冷却し、PBT を反応床に 移した後、窒素を系内に 13.3kPa となるように 導入し、所定の温度まで昇温して 30 分保持し、 接触分解を行った。この間、サンプリングポー トから系内ガスをサンプリングし、分析した。

#### 2.3分解生成ガス分析

水素、一酸化炭素、二酸化炭素及びメタンの 分析には 3mm $\phi$  (*i.d.*) × 3m の SUS 管に Unibeads-C (80/100mesh、GL Science 製)を充 填した分離カラムを取付けた TCD-GC (島津 GC-8APT、島津製作所製)を用い、オーブン温 度は 50℃から 80℃まで 5℃/min で昇温した。C<sub>1</sub> ~C<sub>4</sub>炭化水素の分析には 3mm $\phi$  (*i.d.*) ×4m の SUS 管に Unipack-S (100/150mesh、GL Science 製)を充填した分離カラムを取付けた FID-GC (GC9A、島津製作所製)を用い、50℃から 150℃ まで 5℃/min でオーブンを昇温した。なお、キ ャリヤーガスにはいずれもアルゴンを用い、通 気量は 50ml/min で通気した。

#### 2.4 PBT 残さ表面物質の分析

PBT 接触分解実験後の残さ表面物質を熱分解 装置(フロンティア・ラボ製、EGA/PY-3030D) を用いて 300℃で 0.2 分加熱処理した際の分解 生成ガスをガスクロマトグラフ質量分析装置 (GC/MS)(Agilent technology 製、7890B)を用 いて定性分析した。GC カラムには Ultra ALLOY 5 (30m×250µm×0.25µm、フロンティア・ラ ボ製)を用い、昇温条件は 40℃(2min) →20℃ /min→300℃(13min)とした。また、注入口温 度は 300℃、スプリット比は 50:1 とした。

PBT の主鎖切断では、図2に示す様にエステ

![](_page_44_Figure_11.jpeg)

ル結合が切断されて dibut-3-enyl terephthalate が生成する<sup>7)</sup>。そのため、本研究ではこれを 指標物質として、主鎖切断の程度を比較した。

#### 3 結果及び考察

#### 3.1 分解生成ガス分析

金属接触下における樹脂からの分解生成ガ ス量について検証するため、PBT 単独及び Fe/SiO<sub>2</sub>、Ni/SiO<sub>2</sub>と接触させた PBT (以下、 PBT+Fe/SiO<sub>2</sub>及び PBT+Ni/SiO<sub>2</sub>)を窒素雰囲 気下、260℃、280℃及び 300℃で 30 分保持し た結果、発生した分解生成ガス量を図 3 に示 す。PBT 単独の場合、260℃、280℃及び 300℃ における分解生成ガス量はそれぞれ 0.6µmol、 3.3µmol 及び 5.4µmol だったのに対し、PBT +Fe/SiO<sub>2</sub> ではそれぞれ 7.2µmol、9.9µmol 及 び 17.7µmol 、PBT+Ni/SiO<sub>2</sub> ではそれぞれ 10.5µmol、13.2µmol 及び 33.3µmol だった。

![](_page_45_Figure_4.jpeg)

図3 種々の温度における PBT 単独、PBT+ Fe/Si02 及び PBT+Ni/Si02の分解生成ガス量

このように、分解生成ガス量は PBT 単独< PBT + Fe/SiO<sub>2</sub> < PBT + Ni/SiO<sub>2</sub> の順で多く、 260℃から 300℃の温度範囲では金属接触下で PBT の分解が促進され、また、Fe と比較して Ni の分解能は高いことが示唆された。

#### 3.2 分解生成ガスの成分分析

PBT からの水素引抜きにより分解生成ガスに 占める水素量が、また、主鎖切断により C1~C4 炭化水素量が増加すると考えられる。図4には 各温度における分解生成ガス中の水素及び C<sub>1</sub> ~C4炭化水素量を示す。PBT 単独ではいずれの 温度でも水素は検出されず、C<sub>1</sub>~C<sub>4</sub>炭化水素生 成量は 260℃、280℃及び 300℃でそれぞれ 0.6µmol、0.9µmol 及び 1.8µmol だった。これに 対し、PBT+Fe/SiO2では、水素量は260℃、280℃ 及び 300℃でそれぞれ 6.9µmol、8.1µmol 及び 9.0µmol であり、C1~C4炭化水素量はそれぞれ 0.3µmol、1.8µmol 及び 7.2µmol だった。さらに PBT+Ni/SiO<sub>2</sub> では水素量が 260℃、280℃及び 300℃でそれぞれ 7.5µmol、7.8µmol 及び 18.3µmol であり、C1~C4炭化水素量はそれぞれ 0.9µmol、2.1µmol 及び 7.8µmol だった。

このように、PBT+Fe/SiO<sub>2</sub>及び PBT+Ni/SiO<sub>2</sub> において種々の温度で水素の生成が見られたこ とから、PBT からの水素引抜きは金属との接触 により引き起こされたことが示唆された。さら に、260℃から 280℃にかけて、C<sub>1</sub>~C<sub>4</sub>炭化水素 量は金属接触下で多少増加したものの、金属の 有無により大きな差異が見られなかったのに対 し、水素量は金属接触下で大幅に増加したこと から、金属との接触により PBT からの水素引抜 きが優先的に起きたことが示唆された。

![](_page_45_Figure_10.jpeg)

図 4 種々の温度で生成した分解生成ガス中の水素量(実線)及び C<sub>1</sub>~C<sub>4</sub>炭化水素量(点線) (1:PBT 単独、2:Fe/SiO<sub>2</sub>、3:Ni/SiO<sub>2</sub>)

また、280℃から 300℃にかけて、PBT+

Ni/SiO<sub>2</sub>の水素量は PBT+Fe/SiO<sub>2</sub>と比較して 著しく増加した。これに関しては、Niの PBT 主鎖からの水素引抜きに対する活性が高くな ったことに加え、分解生成した  $C_1 \sim C_4$ 炭化水 素からも水素が引抜かれた可能性が推定され た。

一方で、280℃から 300℃にかけて、PBT 単
 独、PBT+Fe/SiO<sub>2</sub> 及び PBT+Ni/SiO<sub>2</sub> の C<sub>1</sub>~
 C<sub>4</sub>炭化水素量はそれぞれ 2.0、4.0 及び 3.7 倍
 に増加した。このように金属との接触による
 主鎖切断が水素引抜きと比較して高い温度域
 で促進されたことは両反応の反応機構が異なることを反映していると考えられた。

#### 3.3 PBT 残さ表面物質の分析

前節までは主に分解生成ガスの分析により 金属による PBT の分解促進効果について検 証した。そこで、分解実験に供した PBT 残さ に関し、金属による主鎖切断に伴う低分子量 物質に注目して分析し、主鎖切断促進機構に ついて知見を得ることとした。なお、PBT 残 さには、PBT の実成形温度域であり、かつ金 属接触下で主鎖切断の促進が見られた 280℃ で分解実験に供した試料を用いた。

表1に示す様に、PBT単独における dibut-3-enyl terephthalate 生成量を1とした場 合、PBT+Fe/SiO<sub>2</sub>及び PBT+Ni/SiO<sub>2</sub>の指標 物質量比は1.8及び1.9 だった。

このことから、PBT 残さ表面の指標物質量 は金属接触下で増加し、前述の 280℃におけ る分解生成ガス中の  $C_1 \sim C_4$  炭化水素量と同 様の傾向を示した。このように、ガス量、ガ ス組成に関するガス分析と PBT 残さ表面物 質中に含まれる低分子量物質の分析の両面か ら金属接触下における PBT の主鎖切断の促 進が確かめられた。

#### 4 結論

①金属接触下で PBT の分解が促進され、Fe と比較して Ni の分解能は高いことが示唆さ れた。

②金属接触下では PBT からの水素引抜きが 起こり、また、PBT の実成形温度域では PBT 主鎖からの水素引抜きが主鎖切断よりも優先 されことが示唆された。 ③金属接触下で見られた PBT からの水素引抜 き及び主鎖切断は別々に進行したことが推測さ れた。

④PBT 残さ表面物質における指標物質量から も金属接触下で PBT の主鎖切断が促進される ことが示唆された。

以上のことから、PBT 単独、PBT+Fe/SiO<sub>2</sub>及 び PBT+Ni/SiO<sub>2</sub> では、図5に示す様な機構で PBT の分解が起きると推測された。

# 表 1 種々の PBT 残さにおける指標物質量比(PBT 単独の指標物質の量を1とした)

![](_page_46_Figure_13.jpeg)

図5 PBT 単独(A)、PBT+Fe/SiO<sub>2</sub>及び PBT +Ni/SiO<sub>2</sub>(B)における PBT の推定分解挙動 M:Fe、Ni

#### 参考文献

- 1)芥川:機械設計, 52, 99(2008)
- 2) H. Nishimura, T. Motoda and Y. Itoh : Soc. Plast. Eng. Annual Tech. Conf., 2, 2572(1992)
- 3)青葉:型技術,22,5(2007)
- 4) 伊藤:日本ゴム協会誌, 73, 562(2000)
- 5) 恩田、鈴木ら, 群馬産業技術センター研究 報告, 16, 2012.
- 6) 鈴木、黒岩ら,成形加工,24,590(2012)
- 7) S. Tsuge, H. Ohtani and C. Watanabe(2011).
   Pyrolysis GC/MS Data Book of Synthetic Polymers, Elsevier.

## 定量性を備えた昇温脱離装置を用いた計測技術の開発

牛木龍二·恩田紘樹

## Development of measurement technology by quantitative temperature programmed desorption apparatus Ryuji USHIKI, Koki ONDA

活性化された金属(活性金属)にプローブガスを吸着させ、その脱離温度から活性金属 の表面状態を評価することを目的として昇温脱離(TPD)装置を設計、試作した。また、 TPD 装置の性能を評価するために、表面特性が良く知られているシリカ担持ニッケル触 媒(Ni/SiO<sub>2</sub>)の CO-TPD 測定を行った結果、物理吸着および化学吸着した CO に由来す ると考えられる脱離ピークが確認された。このことから、本研究で試作した TPD 装置を 用いることで、活性金属の表面状態を評価できることが確認できた。

キーワード: CO-TPD、シリカ担持ニッケル触媒、物理吸着、化学吸着

Temperature programmed desorption (TPD) apparatus was designed and set up to measure desorption behavior of probe gas like carbon monoxide. It has been, for instance, considered that desorption temperature may reveal chemical state of active site. Therefore, measurement of CO-TPD was made on well-defined silica supported nickel catalyst (Ni/SiO<sub>2</sub>) to confirm performance of the designed TPD apparatus and as a result, physisorbed and chemisorbed CO were recognized on Ni/SiO<sub>2</sub>. These results suggested that surface information on active site of heterogeneous catalysts could be evaluated by using the designed TPD apparatus in this work.

Keywords : CO-TPD, Ni/SiO<sub>2</sub>, physisorption, chemisorption, active sites

#### 1 はじめに

金属試料の表面分析には X 線光電子分 光(XPS)や電子線マイクロアナライザー (EPMA)が汎用的に用いられる。しかし、 センターが保有するこれらの装置では、測 定前に試料を外気に露出する必要があり、 触媒や摺動部材といった活性の高い金属表 面を *in situ* で評価することは困難な状況 である。

一方、試料にプローブガスを飽和吸着さ せた後、試料温度を連続的に上昇させた場 合の脱離温度および脱離量を測定する昇温 脱 離 法 (Temperature Programmed Desorption:TPD)では、表1に示す様にプ ローブガス種により固体金属表面に関する 様々な知見が得られる。

表	1	TPD 測定で代表的なプローブガス
種	と得	られる固体表面の情報

プローブガス種	得られる固体表面の情報
СО	活性金属表面積、金属分散度
CO <sub>2</sub>	塩基点の数、強度
$NH_3$	酸点の数、強度

これらを踏まえ、本研究では活性化された金属(活性金属)にプローブガスを吸着させ、その脱離温度から活性金属の表面状態を評価することを目的として、TPD 装置を設計、試作した。また、試作した TPD 装置を用い、表面特性がよく知られているシリカ担持ニッケル触媒(Ni/SiO<sub>2</sub>)の

![](_page_48_Figure_0.jpeg)

#### 図 1 本研究で作製した TPD 装置の PFD

CO-TPD を測定し、活性金属の表面状態の 評価につながる可能性について検証した。

#### 2 TPD 装置の設計および作製

本研究で作製した TPD 装置の PFD を図 1 に示す。配管には外径 3.17mm(内径 2.17mm)のジーエルサイエンス製 SUS316 配管を用い、調圧弁にはユタカ製 GF2-2506-LN-V、ボールバルブ(BV) には Swagelok 製 SS-41GS2、六方切り替えバル ブ(SV) にはジーエルサイエンス製 GS-231、 マスフローコントローラー(MFC) にはコ フロック製 MODEL8500 を用いた。また、 反応床には外径 10mm(肉厚 1mm)の PYREX<sup>®</sup>製ガラスを用い、グリースレスバ ルブには草野科学製 SA-3 を用いた。なお、 反応床の材質にガラスを用いたのは、プロ ーブガスと反応する可能性が低いこと、反 応床内部を目視により観察できること、お よび試料の設置や交換が容易なためである。

反応床の加熱には 0.6kW の電気炉を用 いた。また、反応床温度はシマデン製温調 装置を用い制御し、温度の計測には熱電対 を用いた。さらに反応床からの出口ガスを 直接分析するため、TPD 装置に熱伝導度 検出器型ガスクロマトグラフ(TCD- **GC)(GC-8A**、島津製作所製)をオンライン で接続した。

3 試作 TPD 装置による Ni/SiO₂の CO 昇 温脱離測定

#### 3. 1 Ni/SiO2触媒の調製

SiO<sub>2</sub>(Silica Gel60、比表面積 410m<sup>2</sup>/g 、 Merck 製)を電気炉(FO-300、ヤマト科学 製)で 500 ℃で 2 時間焼成した。仕上がり の試料重量基準で Ni が 10wt.%含有される よう、硝酸ニッケル六水和物(Ni(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>・6 H<sub>2</sub>O、試薬特級、和光純薬製)にイオン交 換水を溶解させた。これにイオン交換水を 加え、飽和吸水量の約 1.2 倍容の硝酸ニッ ケル水溶液を調製した。この水溶液を予め 焼成した所定量の SiO2 に含浸させ、1 時 間静置した。得られたスラリーをロータリ ーエバポレーターに移し、50 ℃に加温し ながらアスピレーターで減圧乾燥後、石英 製炉心管に移し、横型管状電気炉(KTF-30 N、光洋製)で空気を約 200ml/min で通気し ながら 500 ℃で 2 時間焼成し、SiO2 担持 Ni 触媒(Ni/SiO<sub>2</sub>)の前駆体を得た。

#### 3.2 試料の前処理

§3.1 で調製した Ni/SiO2 触媒 0.5g をTPD 装置の反応床に設置後、図2に示す

![](_page_49_Figure_0.jpeg)

図2 測定試料前処理の温度プロフィール

試料の前処理工程を行った。試料の前処理 時には図1中の SV を切り替え、ガスが破 線部に流れるようにした。以下、具体的な 手順を記載する。

(工程1:昇温) 調圧弁1および BV1を 開け、He ガスを MFC1により流量を 50ml/min に制御し、反応床へ導入しなが ら、反応床を電気炉を用いて室温から 500 ℃に昇温した。このとき 500 ℃に昇温す るまでに 30 分を要した。

(工程2:活性化)反応床の温度を 500℃
 に保持しながら調圧弁1および BV1を閉じ、調圧弁2および BV2を開け、H2を
 MFC1により流量 50ml/min に制御しながら反応床に導入し、1時間保持した。

(工程3:降温)調圧弁2および BV2を 閉じ、調圧弁1および BV1を開けて He ガスを MFC1により流量 50ml/min に制御 し、反応床に導入しながら、反応床温度を 50℃まで降温した。このとき 50℃に降温 するまでに 10 分を要した。

(工程4:CO吸着)調圧弁1およびBV
1を閉じ、調圧弁3およびBV3を開け
10%CO(バランス:He)をMFC1により
流量 50ml/min に制御しながら反応床に導入して1時間保持し、試料にCOを飽和吸着させた。

![](_page_49_Figure_7.jpeg)

![](_page_49_Figure_8.jpeg)

(工程5:未吸着 CO 除去)調圧弁3および BV3を閉じ、調圧弁1および BV1を開け He ガスを MFC1 により流量 50ml/min で反応床に導入して 10 分間保持し、未吸着の CO を系内より排除した。その後、調圧弁1および BV1を閉じた。

#### 3. 3 Ni/SiO<sub>2</sub>の CO-TPD 測定

CO-TPD 測定時には調圧弁1および BV 4を開け、かつ SV を切り替えて He が実 線部に流れるようにした。また、He の流 量制御には MFC 2 を用い、流量は 50ml/min (stp) で保持した。反応床を電 気炉で昇温速度 10°C/min で 50 から 500°C まで昇温した。昇温過程で触媒から脱離し てくる CO は分離カラムを用いず、TCD- GC の検出器に導入した。この際に TCD-GC 用の MFC に差圧を持たせるため、ガ ラスビーズ (60~80 メッシュ)を充填し た  $3mm\phi \times 2m$ の SUS 管をカラムの代わり に取り付けた。なお、オーブン温度は 50 °C に保った。

#### 4 結果および考察

#### 4. 1 TPD 装置の性能評価

本実験で設計、試作した TPD 装置の性 能を評価するため、Ni/SiO<sub>2</sub> 触媒の CO-TPD 測定を行った。図3に示す様に、脱 離スペクトルには2本のピークが見られ、 低温側及び高温側の CO 脱離ピーク温度は それぞれ98℃ および167℃ だった。

Ni 担持量が 20wt.%の Ni/SiO<sub>2</sub> 触媒を用 いた CO-TPD では、90 ℃ と 180 ℃ にそれ ぞれ物理吸着 CO および化学吸着 CO の脱 離に起因すると思われるピークを示す脱離 スペクトルが報告されている 1)。本研究 で試作した TPD 装置を用いた Ni/SiO2 触媒 の CO-TPD 測定では 98 ℃ と 167 ℃ にそ れぞれピークが観測されたことから、担持 Ni 上の物理吸着 CO および化学吸着 CO を 検出できていると考えられた。脱離温度に 差異が見られたことに関しては、実際に本 研究で用いた Ni 担持量 10wt.%の Ni/SiO2 触媒での脱離ピーク同士は重なっていなか ったのに対し、担持量 20wt.%の Ni/SiO2 触 媒では、低温と高温の脱離ピークが重なる ことが報告されており、後者では、脱離量 が多いためにピーク同士が重なり、見かけ の脱離温度がシフトした可能性が考えられ た。一般的に、金属担持触媒では担持量が 高い場合には、担持金属が還元されやすく 2)、低酸化数を示す傾向がある。このこ とから、Ni 担持量が 20wt.%の Ni/SiO2 触 媒では、Ni 担持量 10wt.%の Ni/SiO2 触媒 に比べ Ni<sup>0</sup>のような還元サイトが多いため に、化学吸着を反映する高温での脱離量が 多く、脱離温度がシフトしたことも影響し ていると推定された。

今回試作した TPD 装置は、CO の吸着エ ネルギー、吸着量を測定することが可能で あることが確認された。今後は、実用部材 の表面状態の考察に活用したい。

#### 5. まとめ

①TPD装置を設計、作製した。

②本研究で設計、作製した TPD 装置を用い Ni/SiO2の CO-TPD を行ったところ、2つの CO 脱離ピークが確認され、担持 Ni 上の物理吸着 CO および化学吸着 CO を検出できていると考えられた。

今後、さらに TPD 装置を改良し、プロ ーブガスの金属表面反応による生成物も定 量分析測定できるようにすることで、 in situ な金属表面状態の評価が可能になるも のと思われる。

#### 文献

1)森聰明, 增田浩之, 今井寿穂, 村上雄
 -, *日本化学会誌*, <u>11</u>, 1443-1448(1979)
 2)野沢勲, 白崎高保, *日本化学会誌*, <u>8</u>, 1062-1065 (1978)

群馬県立産業技術センター研究報告
 平成28年度(2016)
 平成29年11月 印刷

発行 群馬県立群馬産業技術センター 〒379-2147 前橋市亀里町 884 番地1
電 話 (027) 290-3030(代)
FAX (027) 290-3040